

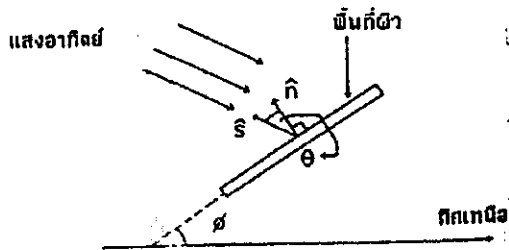
บทที่ 2

ความรู้พื้นฐานของการสร้าง

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [1-2]

2.1.1 กำลังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์

กำลังแสงที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับทิศทางของแสงที่ตกกระทบและพื้นที่รับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถแสดงในทิศทางต่างๆ ได้ดังรูป 2.1 และแสดงซึ่งความสัมพันธ์ได้ดังสมการ 2.1



รูปที่ 2.1 ทิศทางของแสงและพื้นที่รับแสง

$$P_i = (I_s)(A_n) = I \cos \theta \quad (2.1)$$

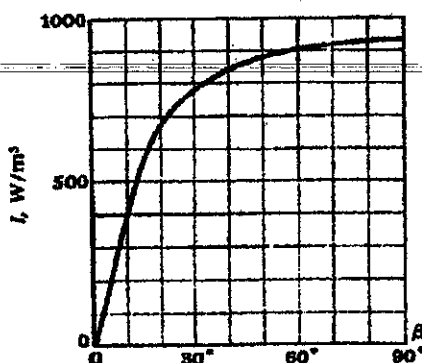
โดยที่	P_i	กำลังงานแสงที่ตกกระทบ
	I	ความเข้มของแสง
	s	เวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่แสดงทิศทางของแสง โดยมีทิศทางจากเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังดวงอาทิตย์
	n	เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของพื้นที่รับแสง โดยมีทิศทางตั้งฉากและพุ่งออกจากพื้นที่ผิว
	A	ขนาดของพื้นที่รับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
	θ	มุมตกกระทบของแสง กับระนาบตั้งฉากของแผงโซลาร์เซลล์

2.1.2 ความเข้มของแสงแสงอาทิตย์

ความเข้มของแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นความเข้มแสงจะขึ้นอยู่กับมุมสุริยะ (Solar Altitude, B) ซึ่งมุมสุริยะนี้จะเป็นมุมระหว่าง s และแนวระนาบในทิศ

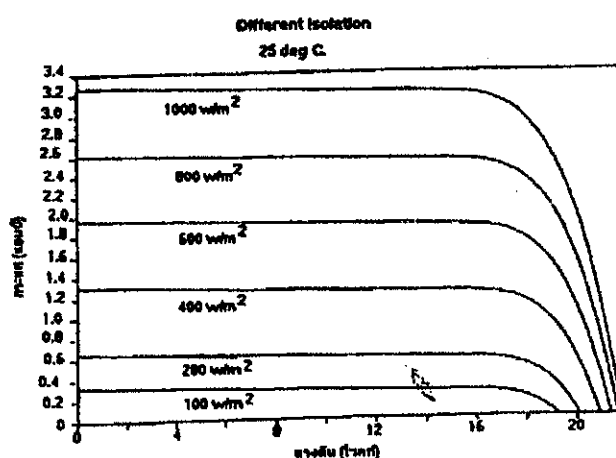
ตะวันออกและตะวันตกคั้งนั้นสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงและมุมสุริยะได้ดังสมการที่ 2.2 และรูปที่ 2.2

$$I = I_0 * e^{-[0.1 / \sin B]} \quad (2.2)$$



รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของความเข้มแสงและมุมสุริยะ

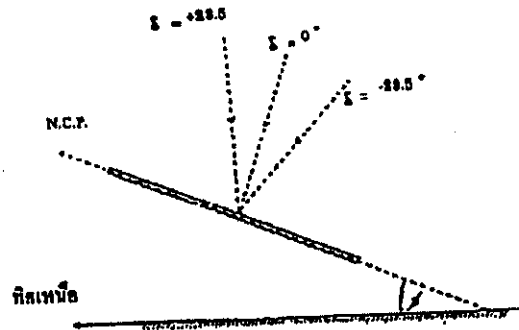
จากความสัมพันธ์นี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ความเข้มของแสงเทียบกับกระแสและแรงดัน

2.1.3 การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่

การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่นี้ จะต้องให้แกนของแผงนั้นทำมุมเอียงในทิศเหนือได้ ซึ่งจะเอียงในทิศทางเหนือ-ใต้ โดยการเอียงนั้นขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นๆอยู่ ณ บริเวณซีกโลกใด ดังรูปที่ 2.4



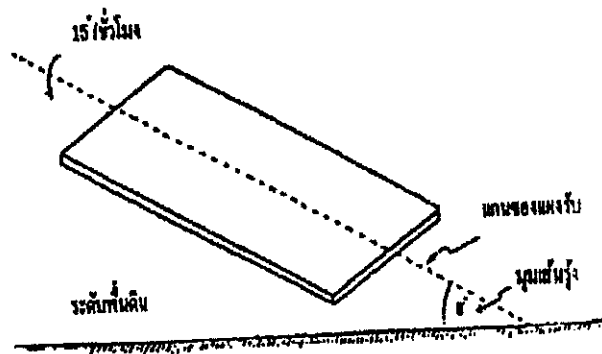
รูปที่ 2.4 แสดงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบอยู่กับที่

2.1.4 การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์

ระบบนี้ใช้การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เป็นตัวกำหนดตำแหน่ง โดยตรวจจับทิศทางของดวงอาทิตย์ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใด แล้วก็ทำการเปรียบเทียบตำแหน่งแล้วส่งสัญญาณไปควบคุมแผงให้ติดตามดวงอาทิตย์ ซึ่งในระบบนี้จะแบ่งได้อยู่ 2 ระบบ คือ

1. ระบบอิกวาทอร์ (Equatorial Mounting)

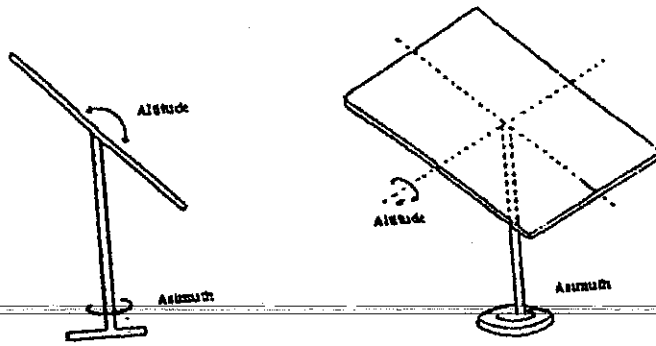
ระบบนี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะหมุนได้เพียง 1 แกน คือจะหมุนรอบๆแกน เหนือได้ หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะหันไปในทิศตะวันออก- ตก ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ติดตามแบบอิกวาทอร์

2. ระบบอซิมุท (Azimuth Mounting)

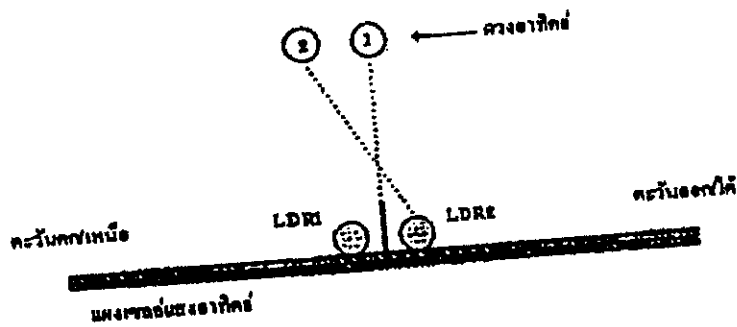
ระบบนี้จะหมุนรอบแกนถึง 2 แกน ซึ่งจะหมุนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกในแต่ละวัน และจะหมุน ในทิศเหนือ - ใต้ ตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในแต่ละฤดูกาล ดังรูป 2.6



รูปที่ 2.6 แสดงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามดวงอาทิตย์แบบออริมิธ

2.1.5 วิธีการปรับทิศทางการรับแสง

วิธีการนี้เป็นวิธีการปรับทิศทางการรับแสงของดวงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้สามารถรับพลังงานได้สูงสุด โดยหลักการนี้อุปกรณ์ไวแสงที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน 2 ตัว วางไว้ด้านข้างของวัตถุที่รับแสงทั้งสองด้าน ซึ่งวัตถุที่รับแสงวางตั้งฉากกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังรูปที่ 2.7 เพื่ออาศัยความเข้มแสงที่เท่ากันเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำมุมตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ ซึ่งนำหลักการนี้เป็นตัวควบคุมการจับทิศทางของดวงอาทิตย์และการปรับทิศทางการรับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์



รูปที่ 2.7 การเปรียบเทียบทิศทาง โดยการบังให้เกิดเงา

2.2 มอเตอร์กระแสตรง (DC motor) [3]

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC moter) เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ อามเจอร์ ขั้วแม่เหล็ก คอมมิวเตเตอร์ และแปรงถ่าน นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบย่อยๆ อีกคือ เฟลา คลับลูกปืน ชุดยึดแปรงถ่าน และ โครงสร้าง เป็นต้น

2.2.1 อามเจอร์

เป็นส่วนที่หมุนติดกับสนามแม่เหล็กเพื่อผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้า โครงสร้างของอามเจอร์ประกอบด้วยแกนเหล็กอาร์มาเจอร์และขดลวดอามเจอร์

2.2.2 แกนเหล็กอาร์มาเจอร์

ทำจากแผ่นเหล็กซิลิกอน ผิวทั้งสองข้างจะฉาบด้วยฉนวนวานิช อัดซ้อนกันเป็นรูปทรงกระบอก เพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากฮิสเตอร์รีซิส และกระแสไหลวนในแกนเหล็ก ผิวด้านนอกของทรงกระบอกจะทำเป็นร่อง (slot) เรียงตามแนวเส้นรอบวงรอบนอกแกนเหล็กเพื่อใช้พันขดลวดคามาเจอร์ ลักษณะของร่องจะมี 2 แบบในมอเตอร์ขนาดเล็ก หรือเครื่องที่มีความเร็วรอบสูง จะใช้ร่องแบบกึ่งปิด แต่ในเครื่องกลไฟฟ้าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ นั้นเนื่องจากขดลวดคามาเจอร์เป็นขดลวดที่พันลวงหน้าจึงจำเป็นต้องใช้ร่องแบบเปิด

2.2.3 ขดลวดคามาเจอร์

ทำจากเส้นลวดคอบนวน กรณีที่มีกระแสไม่มากนักจะใช้ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัดทรงกลม ในกรณีที่มีพิกัดกระแสสูงๆจะหันมาใช้เส้นลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมแบน ส่วนของขดลวดคามาเจอร์ที่บรรจุอยู่ในร่องเรียกว่า คอล์ไซด์ (coil side) และส่วนที่เหลือของขดลวดซึ่งไม่ได้อยู่ในร่องเรียกว่า คอล์เอ็นด์ (coil end) ปกติเมื่อพันขดลวดคามาเจอร์เสร็จแล้วจะใช้ลิ่มไฟเบอร์สตอว์ที่ปากร่องเพื่อป้องกันขดลวดคามาเจอร์หลุดออกจากร่องอันเนื่องมาจากแรงหนีศูนย์กลางในขณะมอเตอร์ทำงาน

2.2.4 ขั้วแม่เหล็ก

เป็นส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็กให้ผ่านแกนเหล็กคามาเจอร์ ขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะยึดติดกับโครงเครื่อง (fram or yolk) และประกอบด้วยขดลวดสนามแม่เหล็ก หรือขดลวดฟิลด์ (field coil) แกนของขั้วแม่เหล็ก (pole core) และ โปลชู (pole shoe)

ก. โครงเครื่อง เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ยึดแกนของขั้วแม่เหล็ก และฝาครอบของเครื่อง นอกจากนั้นยังใช้เป็นทางผ่านของสนามแม่เหล็กเพื่อให้เส้นแรงแม่เหล็กเดินครบวงจร โครงเครื่องอาจทำทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่นที่โค้งงอเป็นรูปทรงกระบอกเพื่อเชื่อมยึดรอยต่อเข้าด้วยกัน

ข. แกนของขั้วแม่เหล็ก ทำมาจากแผ่นเหล็กลามิเนท (Laminate sheet steel) ปั้นเป็นแกนของขั้วแม่เหล็กในแผ่นเดียวกัน แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยมีส่วนที่ยื่นออกจากขอบทั้งสองบริเวณด้านหน้าของขั้วแม่เหล็ก และมีลักษณะงอตามความโค้งของแกนแม่เหล็ก

ค. ขดลวดสนามแม่เหล็ก คือขดลวดที่พันรอบแกนของขั้วแม่เหล็กทุกขั้ว โดยมากมักจะใช้ขดลวดฟิลด์ที่พันไว้ล่วงหน้าหุ้มฉนวนวานิชห่อหุ้มเรียบร้อยแล้ว ไปสวมเข้ากับแกนของขั้วแม่เหล็ก การต่อขดลวดฟิลด์ของแต่ละขั้วเข้าด้วยกันจะต้องทำให้เกิดขั้วเหนือและขั้วใต้สลับกันไป

2.2.5 คอมมิวเตเตอร์

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เรียงกระแสหรือเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับในขดลวดคามาเจอร์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง คอมมิวเตเตอร์ทำจากแท่งทองแดงมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยม เพื่อให้สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกระบอก โดยมีแผ่นไมกาคั่นกลาง ความหนาของแต่ละซี่คอมมิวเตเตอร์ขึ้นอยู่กับ

ขนาดของเครื่องและ โวลท์เตจระหว่างซีคอมมิวเตเตอร์ที่อยู่ติดกัน การต่อปลายสายของขดลวดอามาเจอร์เข้ากับซีคอมมิวเตเตอร์ทำได้โดยต่อปลายสายของขดลวดเข้ากับไรเซอร์ (riser) ซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากปลายด้านหนึ่งของแต่ละซีคอมมิวเตเตอร์

2.2.6 แปร่งถ่านและชุดยึดแปร่งถ่าน

แปร่งถ่านจะสัมผัสผิวหน้าของคอมมิวเตเตอร์ เพื่อต่อวงจรขดลวดอามาเจอร์เข้ากับวงจรภายนอก แปร่งถ่านส่วนมากจะทำมาจากคาร์บอนและแกรไฟต์ แปร่งถ่านคาร์บอนทำมาจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ ใช้ในเครื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีพิกัดกระแสต่ำ แปร่งถ่านแกรไฟต์ที่ทำมาจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ โดยการเพิ่มปริมาณความร้อนจึงเปลี่ยนสภาพเป็นแกรไฟต์ แปร่งถ่านชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ชุดยึดแปร่งถ่านจะทำหน้าที่ยึดแปร่งถ่านให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม มีสปริงที่ทำหน้าที่กดแปร่งถ่านให้สัมผัสกับผิวหน้าของคอมมิวเตเตอร์ ตลอดเวลา ปริมาณกระแสต่อพื้นที่ของแปร่งถ่านที่ใช้ แปร่งถ่านคาร์บอนจะรับกระแสได้ 4-7 แอมป์ต่อตารางซม. แปร่งถ่านแกรไฟต์จะรับกระแสได้ 6-12 แอมป์ต่อตารางซม. ดังนั้น ในเครื่องกลไฟฟ้าที่มีพิกัดกระแสสูง จึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนแปร่งถ่านเข้าไปในแต่ละแท่งตัวนำบนแกนของรอกเกอร์

2.2.7 หลักการทำงานของดีซีมอเตอร์

ดีซีมอเตอร์เป็นทรานสดิวเวอร์แรงบิดที่มีการออกแบบให้มีลักษณะพิเศษคือ แรงบิดของเพลลาของดีซีมอเตอร์จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสอามาเจอร์ แรงบิดของเพลลาของดีซีมอเตอร์จะได้จากผลระหว่างสนามแม่เหล็กและขดลวดตัวนำ ในที่นี้กระแสที่ไหลในขดลวดตัวนำจะสร้างฟิลด์ที่ประกอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็ก (Φ) และขดลวดตัวนำเหล่านั้นอยู่ห่างจากศูนย์กลางการหมุนเท่ากับ (r) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดของเพลลาและกระแสเท่ากับ

$$T = K \Phi I \quad (2.3)$$

เมื่อ	T	แรงบิดของเพลลา มีหน่วยเป็นนิวตันเมตร
	Φ	เส้นแรงแม่เหล็กเป็นเวเบอร์
	I	กระแสเป็นแอมแปร์
	K	ค่าคงที่

ดังนั้นแรงบิดของเพลลาจะเป็นสัดส่วน โดยตรงกับผลคูณของเส้นแรงแม่เหล็กและกระแส เมื่อขดลวดตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดโวลท์เตจตกคร่อมตัวมันเอง โวลท์เตจนี้จะเป็นสัดส่วนกับความเร็วของเพลลาและด้านกรไหลของกระแส ความสัมพันธ์ระหว่างโวลท์เตจย้อนกลับนี้และความเร็วมอเตอร์คือ

$$E = K \Phi N \quad (2.4)$$

เมื่อ	E	โวลต์เตจย้อนกลับ emf มีหน่วยเป็น โวลต์
	Φ	เส้นแรงแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเวเบอร์
	N	ความเร็วรอบของมอเตอร์มีหน่วยเป็นเรเดียน/วินาที

2.2.8 แรงบิดที่ปลายเพลา (Shaft torque)

แรงบิดที่ปลายเพลาคือแรงบิดที่เรานำไปใช้งาน

$$\begin{aligned} T_{sh} &= P_{out} / (2\pi N / 60) \\ &= 9.55 P_{out} / N \quad \text{นิวตัน-เมตร} \end{aligned} \quad (2.5)$$

เมื่อ	T_{sh}	แรงบิดที่ปลายเพลาเป็นนิวตัน-เมตร
	N	ความเร็วเป็นรอบต่อวินาที
	P_{out}	กำลังที่พุดของมอเตอร์เป็น วัตต์

2.2.9 การแยกประเภทคีมอเตอร์

คีมอเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะวิธีการสร้างสนามแม่เหล็กของตัวมอเตอร์และขึ้นอยู่กับพื้นฐานการออกแบบโครงสร้างของอามาเจอร์ การแบ่งประเภทตามลักษณะการจ่ายสนามแม่เหล็กแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ

1. คีมอเตอร์แบบปรับเส้นแรงแม่เหล็กได้
2. คีมอเตอร์แบบเส้นแรงแม่เหล็กมีค่าคงที่

ถ้าเราจะพิจารณาประเภทตามลักษณะการออกแบบ โครงสร้างอามาเจอร์สามารถแยกออกได้เป็น 3 แบบ คือ

1. คีมอเตอร์แบบอามาเจอร์เป็นแกนเหล็ก
2. คีมอเตอร์แบบอามาเจอร์ที่มีขดลวดพันอยู่บนพื้นผิว
3. คีมอเตอร์แบบอามาเจอร์เป็นขดลวดหมุน

นอกจากนี้ยังมีคีมอเตอร์ชนิดพิเศษอีกแบบหนึ่งคือ แบบไม่มีแปรงถ่าน (brushless dc motor) ซึ่งมีหลักการทางเทคโนโลยีเหมือนกับคีมอเตอร์ชนิดมีแปรงถ่านยกเว้น การคอมมิวเตชัน การกระทำโดยเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะกระทำโดยวิธีการทางกล

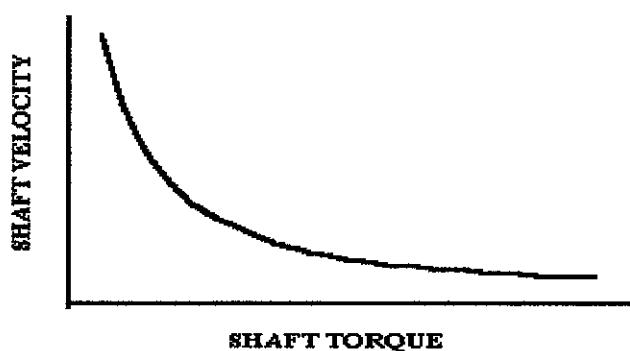
2.2.10 ดีซีมอเตอร์แบบปรับเส้นแรงแม่เหล็กได้

ดีซีมอเตอร์แบบปรับเส้นแรงแม่เหล็กได้ แบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ

- ก.) แบบขดลวดสนามแม่เหล็กต่ออนุกรมกับขดลวดอาามาเจอร์
- ข.) แบบขดลวดสนามแม่เหล็กกระตุ้น

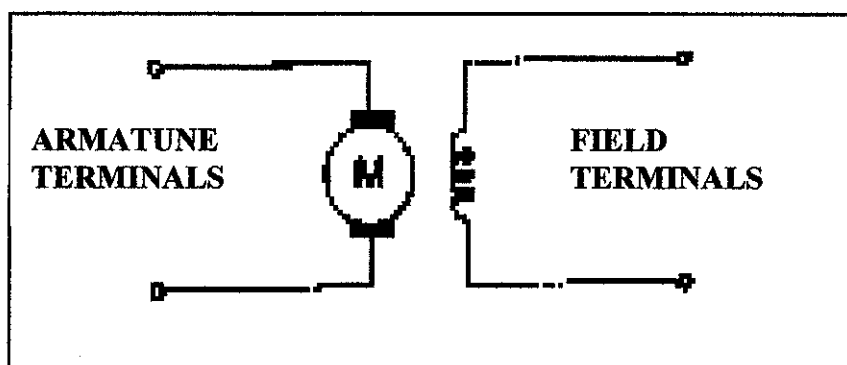
มอเตอร์แบบนี้จะมีเส้นแรงแม่เหล็กเป็นสัดส่วนกับกระแสคังนั้นเส้นแรงของสนามแม่เหล็กจึงสามารถปรับค่าได้ และเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและแรงบิดเป็นนอนลิเนียร์ดังแสดงใน

รูป 2.8



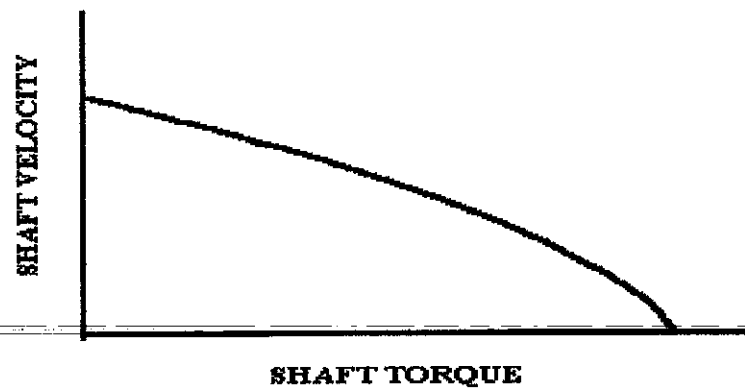
รูปที่ 2.8 คุณสมบัติระหว่างความเร็วและแรงบิดของดีซีมอเตอร์อนุกรมภายใต้สภาวะ โวลต์เตคงที่

มอเตอร์ดังกล่าวจะใช้งานในสภาวะเมื่อต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ เช่นระบบการขับเคลื่อนของรถลาก ตัวอย่างของมอเตอร์แบบขดลวดสนามแม่เหล็กแยกกระตุ้น แสดงในรูป 2.9 ดีซีมอเตอร์แบบนี้มักนิยมเรียกกันว่ามอเตอร์ชานาน (shunt motor) มอเตอร์แบบนี้สามารถปรับเส้นแรงแม่เหล็กได้อย่างอิสระต่อกระแสของอาามาเจอร์ ยังผลให้สามารถควบคุมพารามิเตอร์ของมอเตอร์ให้มีค่าคงที่ตลอดช่วงพิสัยที่กว้าง มอเตอร์นี้มักจะใช้งานในกรณีระบบบังคับการเคลื่อนที่ที่ต้องการแรงบิดสูง



รูปที่ 2.9 ดีซีมอเตอร์แยกปรับสนามแม่เหล็กได้

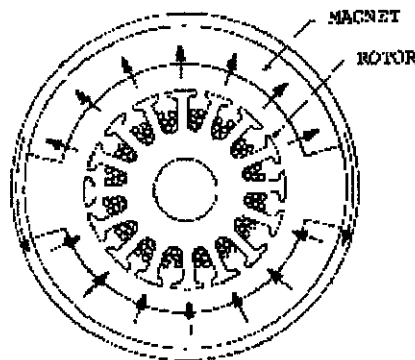
ในรูป 2.10 แสดงถึงคุณสมบัติระหว่างแรงบิดกับความเร็วของชานท์มอเตอร์ภายใต้สภาวะการกระตุ้นสนามแม่เหล็กและอาามาเจอร์คังที่



รูปที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วของชั้นที่มอเตอร์ ภายใต้สภาวะการกระตุ้นสนามแม่เหล็กและอามาเจอร์คงที่

2.2.11 ดิซิมอเตอร์แบบอามาเจอร์เป็นแกนเหล็ก

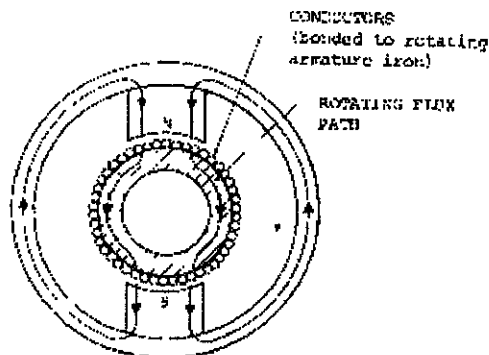
โครงสร้างของโรเตอร์และสเตเตอร์ของมอเตอร์แบบแกนเหล็กแสดงในรูปที่ 2.11 โครงสร้างของมอเตอร์แบบนี้มีโมเมนต์ของแรงเฉื่อยสูงที่สุดและมีค่าอินดักแตนซ์ของโรเตอร์สูงที่สุดด้วยดังนั้นมอเตอร์นี้จึงมีปริมาณการจุกความร้อนได้สูง และสามารถจะทนโอเวอร์โหลดได้ในระยะเวลาที่ยาวนานโดยไม่ทำให้มอเตอร์เสียหาย



รูปที่ 2.11 รูปหน้าตัดของดิซิมอเตอร์แบบอามาเจอร์เป็นแกนเหล็กส่วนฟิลด์เป็นแม่เหล็ก

2.2.12 ดิซิมอเตอร์แบบอามาเจอร์มีขดลวดพันอยู่บนพื้นผิว

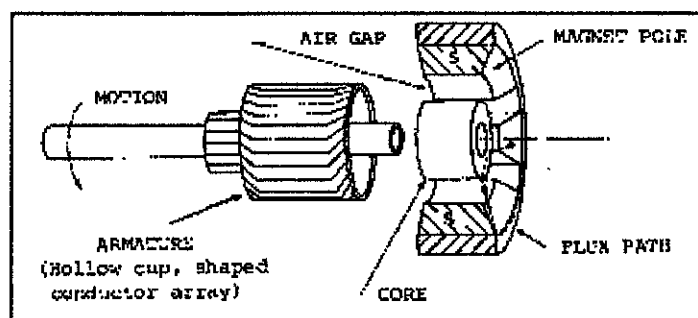
ในรูปที่ 2.12 แสดงถึงการออกแบบของโรเตอร์ที่มีขดลวดพันอยู่บนพื้นผิว โดยไม่มีสล้อททำให้ได้อินดักแตนซ์ของโรเตอร์ต่ำกว่าแบบแกนเหล็ก ข้อเสียคือ ทำให้ขนาดของมอเตอร์แบบนี้ใหญ่ขึ้นและราคาแพงกว่าแบบแกนเหล็กด้วย



รูปที่ 2.12 แสดงรูปหน้าตัดของดีซีมอเตอร์แบบมีขดลวดบนพื้นที่ผิวและฟิลด์เป็นแม่เหล็กถาวร

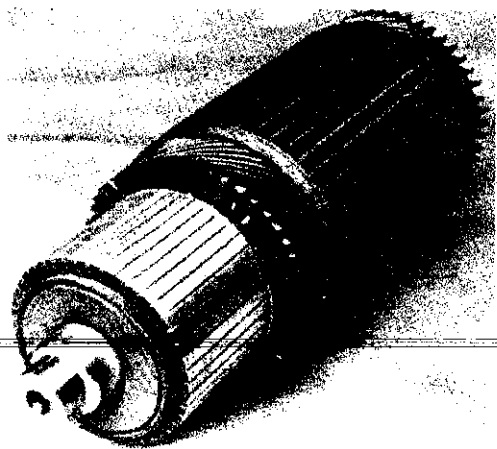
2.2.12 ดีซีมอเตอร์แบบอาร์มาเจอร์แบบขดลวดหมุน

มอเตอร์แบบขดลวดหมุนนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีโมเมนต์ของแรงเสียดน้อยมากดังแสดงในรูป 2.12 และรูปหน้าตัดซึ่งมองด้านข้างของมอเตอร์ดังกล่าวแสดงในรูป 2.13 นอกจากนี้ในรูป 2.14 และรูป 2.15 เป็นรูปถ่ายของอาร์มาเจอร์แบบเป็นขดลวดเคลื่อนที่ และรูปลักษณะโครงสร้างภายนอก และโครงสร้างของแม่เหล็กมอเตอร์แบบนี้มีช่องว่างอากาศ (air gap) ระหว่างแม่เหล็กมากกว่ามอเตอร์ทั้งสองแบบที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างของแม่เหล็กให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ช่องว่างของอากาศระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กที่เท่ากันของมอเตอร์ทั้งสองแบบดังกล่าว ดังนั้นราคาของมอเตอร์แบบนี้จึงมีราคาแพง นอกจากนี้โครงสร้างของโรเตอร์มีประจุความร้อนต่ำมาก หากเกิดโอเวอร์โหลด

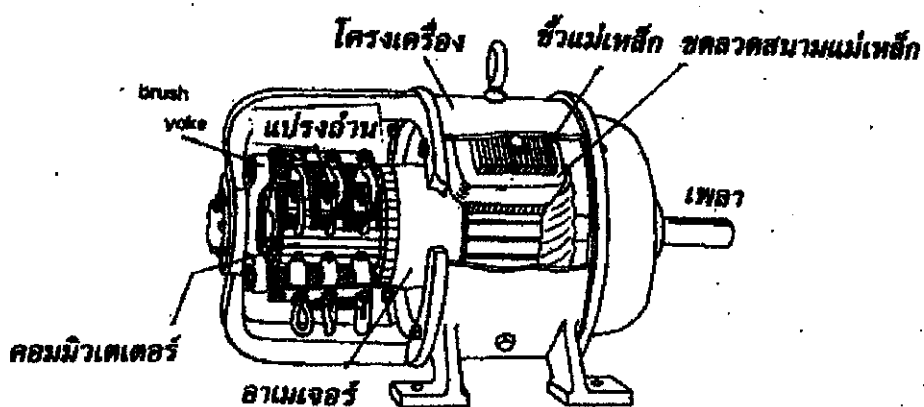


รูปที่ 2.13 รูปหน้าตัดซึ่งมองด้านข้างของดีซีมอเตอร์

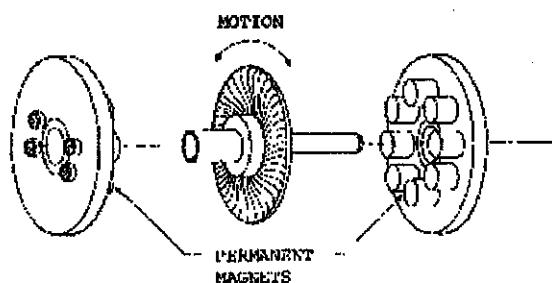
ทำให้มอเตอร์เสียหายได้ง่ายและโรเตอร์ลักษณะนี้จะมีค่าอินดักแตนซ์ต่ำมากคือน้อยกว่า 10 ไมโครเฮนรี่ แบบมีโรเตอร์เป็นขดลวดเคลื่อนที่



รูปที่ 2.14 อาร์มาเจอร์เป็นขดลวดเคลื่อนที่มีรูปร่างเป็นถ้วยตรงกระบอกและเพลลาของอินพุททำด้วยเซรามิกอะลูมิเนียมเพื่อให้ทนต่อแรงดึงได้สูง

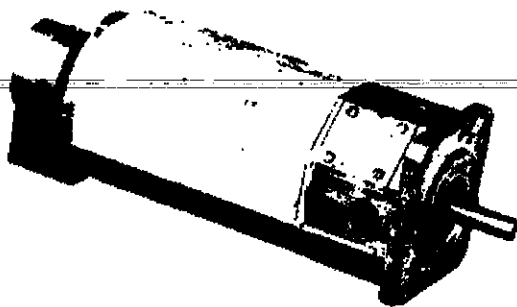


รูปที่ 2.15 รูปร่างและ โครงสร้างแม่เหล็กของมอเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่



รูปที่ 2.16 ดีไซน์มอเตอร์แบบโรเตอร์เป็นขดลวดหมุนแบบรูปร่างเป็นจาน

ในรูปที่ 2.16 แสดงถึงขอลวดเคลื่อนที่ลักษณะหนึ่งซึ่งมีโครงสร้างของอามาเจอร์ เป็นรูปร่างของจานซึ่งทำขึ้นจากขลวดตัวนำซ้อนกันหลายๆ ชั้น ซึ่งเรามักจะเรียกว่า “Printed Motor” ตัวอย่างดังรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 คีซีมอเตอร์แบบโรเตอร์เป็นขลวดชนิดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

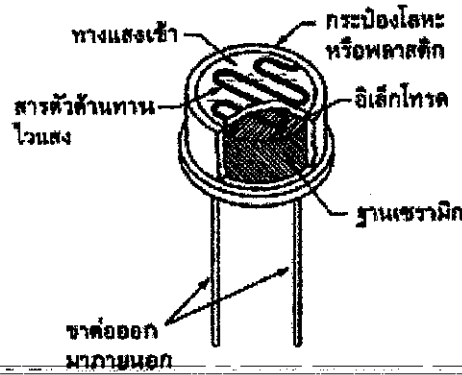
จากรูป 2.10 เป็นมอเตอร์ขนาด 7 แรงม้า ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้แรงบิดสูงถึง 100 ft-lb และพัลส์กระแสได้ถึง 800 แอมป์ ซึ่งในปัจจุบันนำมาใช้มาก เนื่องจากสามารถควบคุมตำแหน่งและให้อัตราส่วนระหว่างแรงบิดและแรงเฉื่อยได้สูง อีกทั้งมีค่าอินดักแตนซ์ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบอื่นๆ นอกจากนี้ความสามารถในการเพิ่มอัตราเร่งยังกระทำให้สูง 10^6 เรเดียน / วินาที²

2.3 LDR ตัวต้านทานไวแสง [4]

ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไวต่อแสง หรือ เปลี่ยนแปลงการทำงานตามปริมาณของแสง มีอยู่หลายอย่าง เช่น LDR (Light Dependent Resistor) โฟโตโวลตาอิกเซลล์ (Photovoltaic cell) ซึ่งจ่ายแรงดันออกมาได้เมื่อได้รับแสง โฟโอดีไดโอด (Photodiode) โฟโอดีทรานซิสเตอร์ (Phototransistor) จนถึงเอสซีอาร์ ที่ทำงานด้วยแสง (LASCR - Light Activated Silicon Controlled Rectifier) ซึ่งใช้หลักการของสารกึ่งตัวนำทั้งนั้นอุปกรณ์ ประเภทนี้มีโครงสร้างและลักษณะการทำงานง่ายที่สุดได้แก่ LDR เพราะไม่ได้ใช้หลักการของรอยต่อ พี - เอ็น เหมือนกันแบบอื่นๆ โดยจะอธิบายในหัวข้อต่อไป

2.3.1 โครงสร้าง

ตัว LDR หรือตัวต้านทานไวแสง (LSR-light sensitive resistor) ส่วนใหญ่ทำด้วยสารแคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) หรือแคดเมียมซีนิไนด์ (CdSe) ซึ่งทั้งสองตัวเป็นสารประเภทกึ่งตัวนำ นำมาฉาบลงบนแผ่นเซรามิกที่ใช้เป็นฐานรองแล้วต่อขาคจากสารที่ฉาบ ไวออกมา

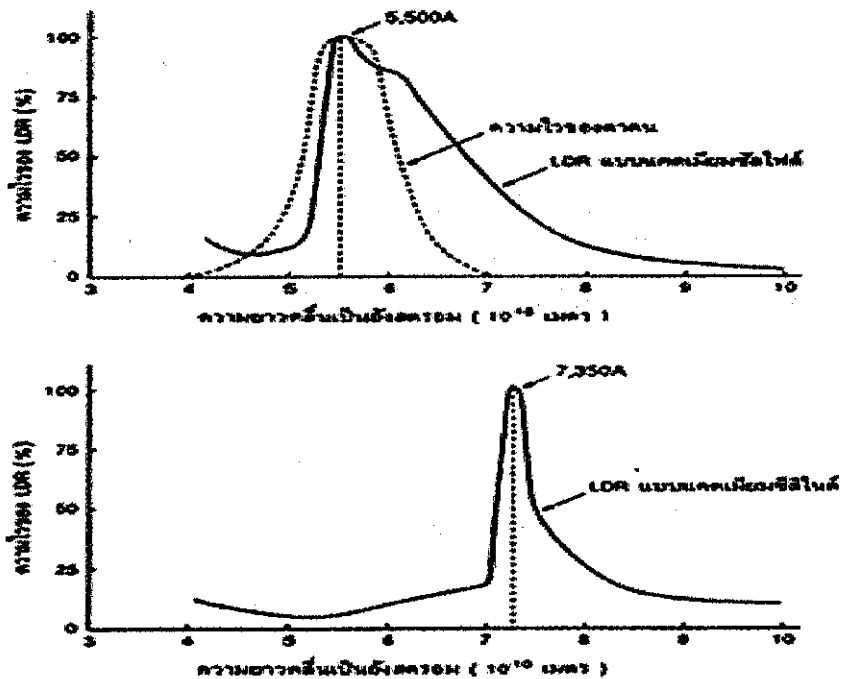


รูปที่ 2.18 โครงสร้าง LDR

รูปร่างดังรูปที่ 2.18 ส่วนที่ขดเป็นแนวเล็กๆ สีดำ ทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานไวแสงและแนวสีดำจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ข้าง ของจริงจะเห็นเป็นสีทอง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สัมผัสกับตัวต้านทานไวแสง เพื่อสำหรับต่อขาออกมาภายนอกหรือเรียกว่าอิเล็กโทรด ฐานเป็นเซรามิกและอุปกรณ์สำหรับท่อหุ้ม มีอยู่หลายแบบ

2.3.2 สมบัติทางแสง

การทำงานของ LDR มีหลักการคือ สารกึ่งตัวนำเมื่อเวลามีแสงตกกระทบ ก็จะถ่ายเทพลังงานให้กับสารที่ฉาบอยู่ ทำให้เกิดโฮลกับอิเล็กตรอนวิ่งชนกัน การที่มีโฮลกับอิเล็กตรอนอิสระมากก็จะทำให้ความต้านทานของ LDR ลดลง ยิ่งความเข้มของแสงที่ตกกระทบมาก ความต้านทานก็ยิ่งลดลง

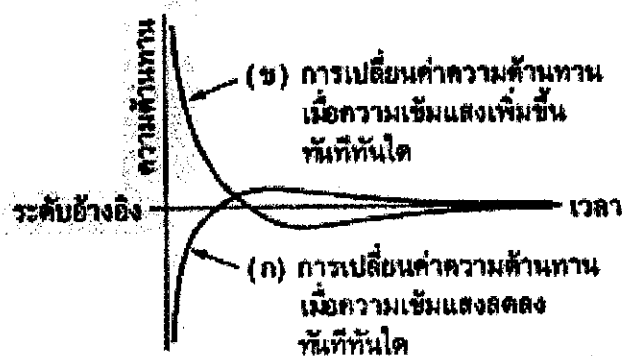


รูปที่ 2.19 แสดงความไวต่อแสงความถี่ต่าง ๆ ของ LDR ทั้ง 2 แบบ เมื่อเทียบกับความไวของตาคน

ในส่วนที่แสงตกกระทบนั่นเป็นแสงช่วงความยาวคลื่นประมาณ 4,000 อังสตรอม (1 อังสตรอม เท่ากับ 10^{-10} เมตร) ถึงประมาณ 10,000 อังสตรอมเท่านั้น (สายตากคนจะเห็นได้ ในช่วงประมาณ 4,000 อังสตรอม ถึง 7,000 อังสตรอม) ซึ่งคิดแล้วก็ในช่วงคลื่นเพียงแคบ ๆ เมื่อเทียบกับการทำงานของอุปกรณ์ไวแสงประเภทอื่น ๆ แต่ถึงอย่างไรแสงในช่วงคลื่นนี้ มีอยู่ในแสงอาทิตย์แสงจากหลอดไฟแบบไส้และแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยหรือถ้าคิดความยาวคลื่น ที่ LDR จะตอบสนองไวที่สุดแล้วมีอยู่หลายความยาวคลื่น โดยทั่วไป LDR ที่ทำจากแคดเมียมซัลไฟด์จะไวต่อแสงที่มีความยาวคลื่นในช่วง 5,000 กว่า อังสตรอม ซึ่งจะเห็นเป็นสีเขียวไปจนถึงสีเหลืองสำหรับบางตัว ความยาวคลื่นที่ไวที่สุดของมันใกล้เคียงกับความยาวคลื่นที่ไวที่สุดของตาคนมาก (ตาคนไวต่อความยาวคลื่น ประมาณ 5,550 อังสตรอม) จึงมักจะใช้ทำเป็นเครื่องวัดแสงในกล้องถ่ายรูป ถ้า LDR ทำจากแคดเมียมซัลไฟด์จะไวต่อความยาวคลื่นในช่วงประมาณ 7,000 อังสตรอม ซึ่งอยู่ในช่วงอินฟราเรด

2.3.3 ผลตอบสนองทางไฟฟ้า

อัตราส่วนระหว่างความต้านทานของ LDR ในขณะที่ไม่มีแสงกับขณะที่มีแสงอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ 100 เท่า 1,000 เท่า หรือ 10,000 เท่า แล้วแต่รุ่น โดยทั่วไปค่าความต้านทานในขณะที่ไม่มีแสงจะอยู่ในช่วง ประมาณ 0.5 MW ขึ้นไป ในที่มีดสนิทอาจมีค่ามากกว่า 2 MW และในขณะที่มีแสงจะมีค่าประมาณ 10 - 20kW ถ้าค่ากว่านี้อาจจะเหลือเพียงไม่กี่โอห์มหรือไม่ถึงโอห์มก็ได้ ทนแรงดันสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 100 V และ กำลังสูญเสีย อย่างต่ำประมาณ 50 mW



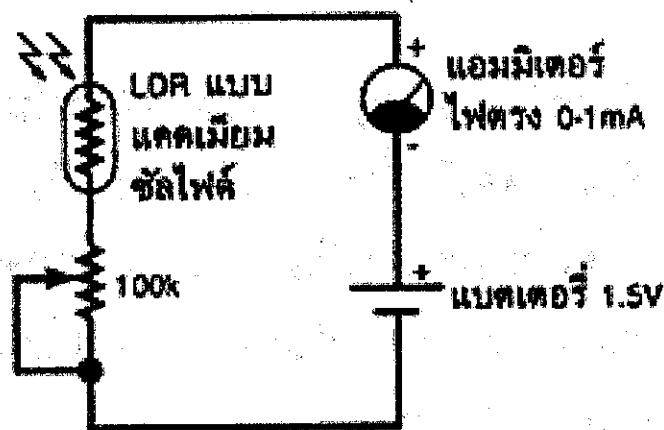
รูปที่ 2.20 ผลของการเปลี่ยนความเข้มแสงในทันทีทันใดกับ LDR

นอกเหนือจากลักษณะสมบัติต่างๆ เหล่านี้แล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเข้มแสงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซึ่งจะดูตัวอย่างได้ในรูปที่ 2.20 ถ้า LDR ได้รับแสงที่มีความเข้มสูงตั้งเส้น (ก) ความต้านทานจะมีค่า ต่ำ และ ในทันทีที่ความเข้มของแสงถูกลดลงเหลือเพียงระดับอ้างอิง ความต้านทานก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปจนถึงค่าความต้านทาน ที่มันควรจะเป็นในระดับอ้างอิง แต่แทนที่มันจะไปหยุดอยู่ระดับอ้างอิง มันกลับ เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วจึงจะลดลงมาอยู่ในระดับ อ้างอิง เหมือนกับว่าเบรกมันไม่ค่อยดีและในทำนองเดียวกันถ้าเก็บมันไว้ในที่ความเข้มแสงน้อยๆ แล้ว

เปลี่ยนความเข้มเป็นระดับอ้างอิงทันที ดังในรูป (๗) ความต้านทานก็จะลดลงต่ำลงมาจากระดับอ้างอิง แล้วจึงขึ้นไปใหม่ ยิ่งความเข้มของแสงเท่ากัน LDR แบบแคดเมียมซีนิไนต์ จะใช้เวลา ในการเข้าสู่สภาวะที่มันควรจะเป็นน้อยกว่า แบบ แคดเมียมซัลไฟด์ แต่ก็จะวิ่งเลยไปไกลกว่าด้วย และ อีกอย่างหนึ่ง ความเร็วในการเปลี่ยนระดับความต้านทานจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งช้ามาก ซึ่งจะอยู่ในช่วงของมิลลิวินาทีหรือ บางทีก็เป็นวินาที จึงทำให้ LDR ใช้ได้ กับงานความถี่ต่ำๆ เท่านั้น

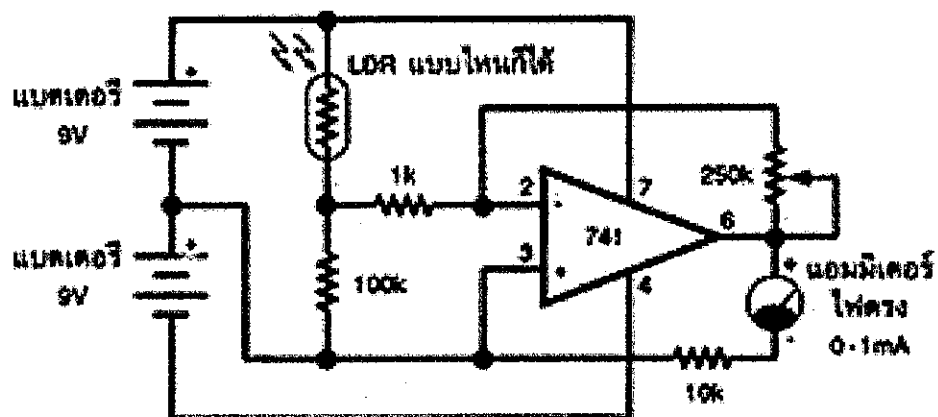
2.3.4 ทำเป็นเครื่องวัดแสง

ในรูปที่ 2.21 เป็นวงจรเครื่องวัดแสงแบบง่ายจริงๆ LDR ที่ใช้ก็ควรจะมีอัตราส่วนของค่าความต้านทานระหว่าง ไม่มีแสงกับมีแสงมากๆ หน่อย เวลาใช้ต้องระวังอย่าให้เข็มมิเตอร์ดีเกินสเกล



รูปที่ 2.21 เครื่องวัดแสงแบบง่ายที่สุด

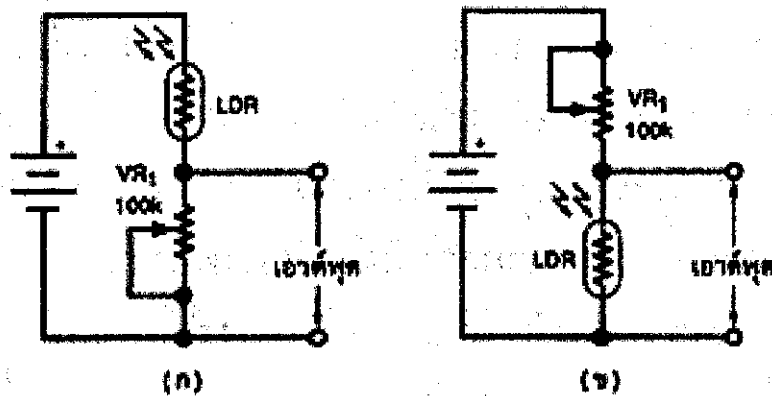
อีกวงจรหนึ่งในรูปที่ 2.22 เป็นวงจรที่ดัดแปลงให้ดีขึ้นแล้วโดยเอาออปแอมป์เบอร์ 741 เข้ามาช่วยทำให้ไวขึ้นมาก หรือใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์มาต่อแทนแบบเข็มก็ได้ แต่ต้องระวังแสงจาก LED จะไปกวนการทำงานของ LDR



รูปที่ 2.22 วงจรเครื่องวัดแสงที่ปรับปรุงขึ้นแล้ว

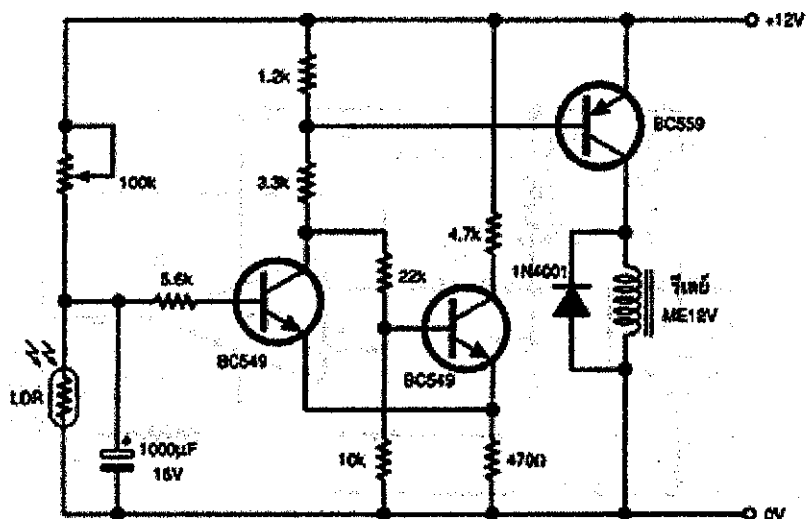
2.3.6 สวิตช์ทำงานด้วยแสง

การใช้ LDR ทำงานในวงจรปิดเปิดสวิตช์จะใช้เพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ มีแสงหรือไม่มีแสง โดยทั่วไปจะใช้วิธีเอาอนุกรมกับตัวต้านทานตัวหนึ่ง แล้วต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดันดังรูปที่ 2.23(ก) จะทำงานดังนี้ คือ ถ้ามีแสงสว่าง LDR จะมีความต้านทานต่ำทำให้แรงดันส่วนใหญ่มาตกคร่อม R1 หมุดแรงดันเอาต์พุตจึงสูงเกือบเท่าแรงดันไฟเลี้ยงและถ้าไม่มีแสง LDR จะมีความต้านทานสูงแรงดันส่วนใหญ่จะไปตกที่ LDR แรงดันเอาต์พุตจึงเกือบเป็น 0 โวลต์



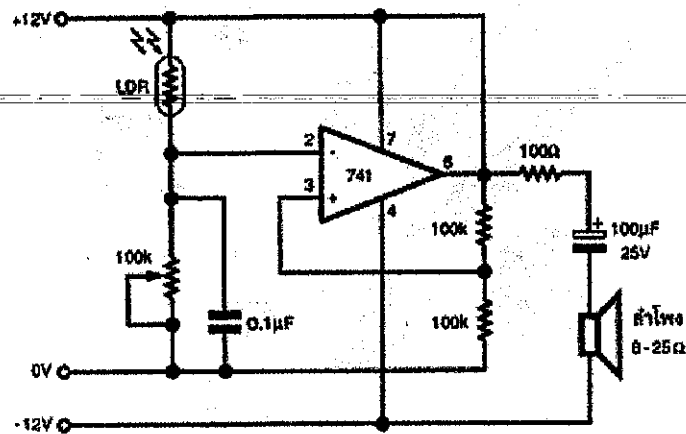
รูปที่ 2.23 หลักการใช้ LDR ในวงจรปิดเปิดสวิตช์

ในรูปที่ 2.23(ข) วงจรจะทำงาน ในทางตรงข้าม เพียงแต่สลับที่ระหว่าง LDR กับ R1 เวลาไม่มีแสงสว่าง เอาต์พุตก็จะเกือบ เป็น 0 โวลต์ เวลาไม่มีแสงสว่างเอาต์พุตก็เกือบเท่าแรงดันไฟเลี้ยงจะเห็นได้ว่า กลับกับกรณีแรก



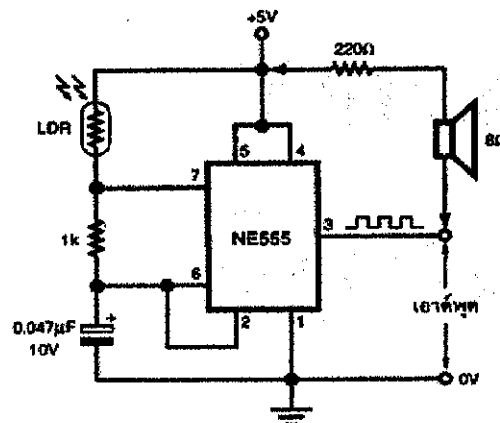
รูปที่ 2.24 ตัวอย่างวงจรควบคุมสวิตช์โดยรีเลย์จะทำงานเมื่อ ไม่มีแสงสว่าง

ทั้ง 2 กรณี จะมีวงจรที่ต่อออกไปสำหรับจับสัญญาณว่ามีแสงสว่างหรือไม่ แล้วนำไปควบคุม สวิตซ์ให้ทำงานในกรณีที่ต้องการ ในรูปที่ 2.24 เป็นตัวอย่างวงจรซึ่งรีเลย์จะทำงานเมื่อไม่มีแสงสว่าง ซึ่งถ้าเราไม่ต้องการแบบนี้และอยากให้รีเลย์ทำงาน เมื่อมีแสงสว่างก็เพียงแค่สลับที่ระหว่าง LDR กับ ความต้านทานปรับค่าได้ 100 kW เท่านั้น



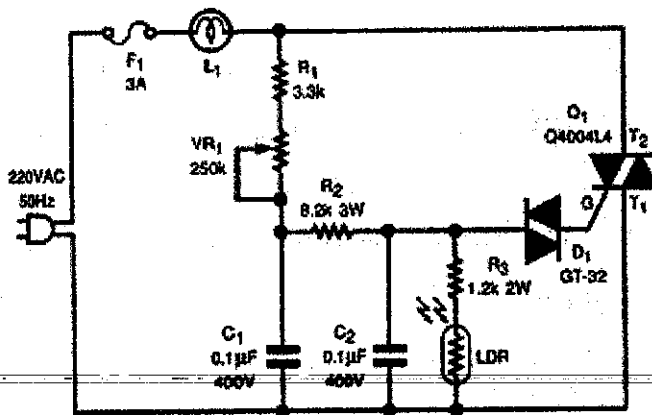
รูปที่ 2.25 วงจรเตือนภัยเป็นเสียงเมื่อมีแสงสว่างกระทบ LDR

ในรูปที่ 2.25 ก็เป็น ตัวอย่างวงจรอีกอันหนึ่งทำงานเมื่อมีแสงสว่าง ตัวอย่างอื่นๆ ก็ได้แก่ วงจร จับควันไฟ วงจรกะพริบ เพื่อความปลอดภัยเมื่อมีรถยนต์แล่นผ่านมา ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ยาก คงจะ นำไปดัดแปลงใช้กันได้ใช้ LDR ตลอดช่วง



รูปที่ 2.26 ตัวอย่างวงจรเปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณ

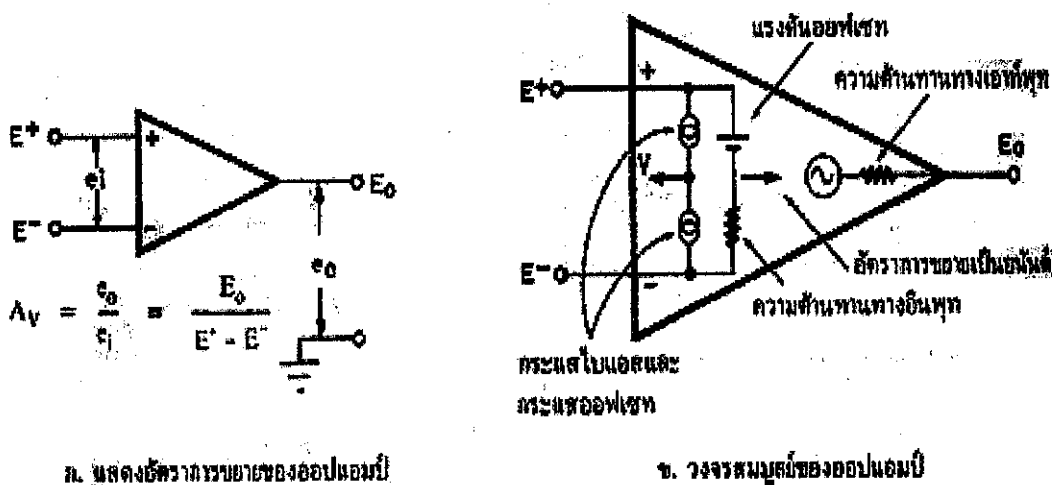
นอกจากวงจรเครื่องวัดแสง การประยุกต์ LDR ให้ใช้งานแบบทุกช่วงการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยัง ดัดแปลงไปใช้ในวงจรอื่นๆ อีก เช่น วงจรแปลงสัญญาณอะนาล็อก เป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อเชื่อมต่อ ส่วนที่เป็นวงจรอะนาล็อก ให้ส่งสัญญาณผ่านเข้าไปทำงานในวงจร



รูปที่ 2.27 วงจรเปิด-หรือ-ปิดไฟ

ดิจิทัลได้ ดังเช่น รูปที่ 2.26 เป็นวงจรแปลงระดับความเข้มแสง ซึ่งเป็นสัญญาณ แอนาล็อกให้ ออกมาเป็นจำนวนลูกคลื่นสี่เหลี่ยม ยิ่งความเข้มแสงมากเท่าไร จำนวนลูกคลื่น ที่สี่เหลี่ยมก็จะยิ่งออกมา มากเท่านั้น วงจรนี้ใช้ไอซี 555 ความถี่ของคลื่นที่ออกมาจะได้ประมาณ 22 kHz ถ้าเอาไปปรับแสงใกล้ๆ หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ แต่จะเหลือเพียงประมาณ 1 Hz ในที่มืด ถ้านำลำโพงอนุกรมกับตัวต้านทาน 220W ไปต่อเข้ากับขาที่ 3 และไฟบวกก็จะได้ยินเสียง สูงๆต่ำๆ ตามความเข้มของแสงและตัวอย่างอีก อันหนึ่งจะเห็นได้ในรูปที่ 2.27 เป็นวงจรเปิดหรือปิดไฟ ซึ่งจะควบคุมให้หลอดไฟสว่างขึ้นในขณะที่ แสงสว่างของสภาพแวดล้อมลดลง

2.4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับออปแอมป์ [4]



ก. แสดงอัตราการขยายของออปแอมป์

ข. วงจรสมมูลย์ของออปแอมป์

รูปที่ 2.28 แสดงการทำงานและวงจรสมมูลย์ของออปแอมป์

ออปแอมป์มีสัญลักษณ์และสัญญาณเข้าออก ตามที่แสดงในรูปที่ 2.28 ความสัมพันธ์ของสัญญาณเข้าและออก แสดงด้วยสูตรง่าย ๆ คือ

$$E_0 = A_v(E^+ - E^-) \quad (2.6)$$

A_v เป็นอัตราขยายแรงดันซึ่งมีค่าสูงมาก จึงเป็นคุณสมบัติที่พิเศษสุดของออปแอมป์ ออปแอมป์แบบอุดมคติ จะมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อดังนี้

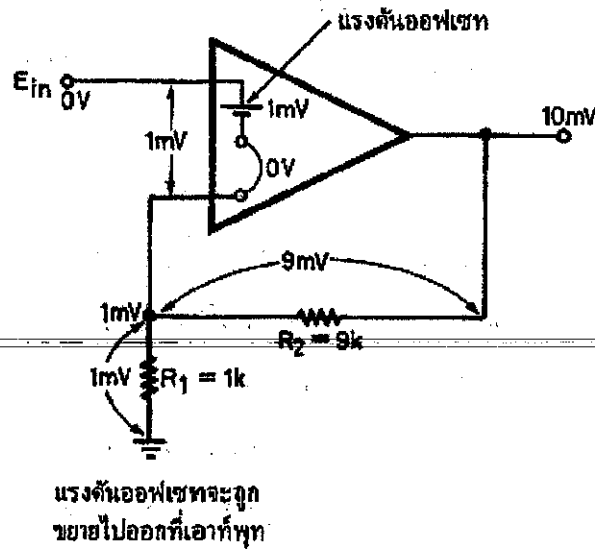
1. อัตราขยายแรงดัน สูงมากจนเป็นอนันต์
2. ความต้านทานทางอินพุต สูงมากจนเป็นอนันต์
3. ความต้านทานทางเอาต์พุต ต่ำมากจนเป็นศูนย์
4. แรงดันออฟเซตทางอินพุตเป็นศูนย์
5. กระแสออฟเซตทางอินพุตเป็นศูนย์
6. ลักษณะสมบัติเชิงความถี่ ขยายได้ตั้งแต่ไฟตรง จนความถี่สูงมากเป็นอนันต์
7. ไม่มีข้อบกพร่องอื่น ๆ

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ออปแอมป์ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างในอุดมคติเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ สำหรับผู้เริ่มต้นในช่วงแรกให้ถือว่าออปแอมป์ที่ใช้ศึกษา กันต่อไปนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับอุดมคติมาก

การใช้ออปแอมป์ที่เป็นอุดมคติในการออกแบบวงจรนั้น เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก หลังจากออกแบบเสร็จแล้ว จึงค่อยมาพิจารณาเงื่อนไข ข้อ หรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่เป็นอุดมคติ แล้วค่อยแก้ไขและปรับปรุงวงจรให้ดีขึ้นอีกทีหนึ่ง

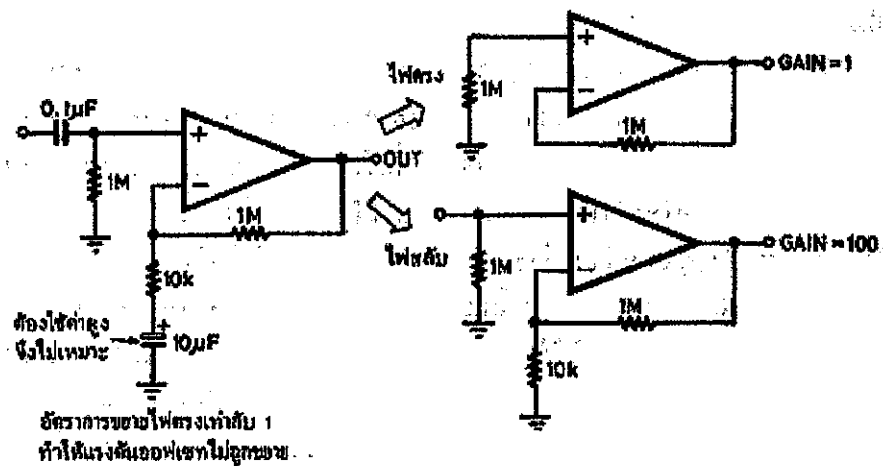
2.4.1 แรงดันออฟเซตทางอินพุต

แรงดันออฟเซตทางอินพุตเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่ง เมื่อเราศึกษาเรื่องออปแอมป์ แรงดันออฟเซตทางอินพุตหมายถึง แรงดันขนาดเล็กที่ปรากฏระหว่างอินพุตบวกลบ ของออปแอมป์ในขณะที่แรงดันอินพุตเป็นศูนย์ ลองดูรูปที่ 2.29 ประกอบ



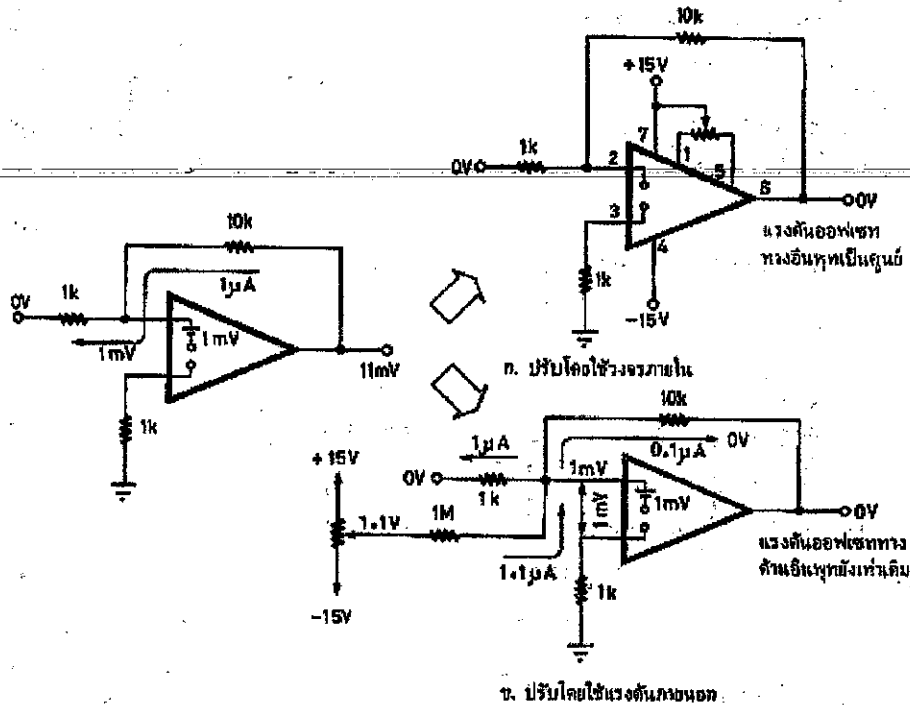
รูปที่ 2.29 แรงดันออฟเซตเปลี่ยนจาก 1 มิลลิโวลต์ เป็น 10 มิลลิโวลต์ ที่เอาต์พุตเมื่อออปแอมป์มีอัตราขยาย 10 เท่า

สำหรับวงจรที่ไม่ต้องการขยายแรงดันไฟตรง มักพยายามกำจัดผลของแรงดันออฟเซตนี้ ไม่ให้ไปปรากฏที่เอาต์พุต อย่างเช่น วิธีการในรูปที่ 2.30 ซึ่งเป็นวงจรขยายแรงดัน ไฟสลับด้วยออปแอมป์ สังเกตจากรูปทางซ้าย มีตัวเก็บประจุคั่นอยู่ ซึ่งคุณสมบัติของตัวเก็บประจุคือจะกันไฟตรงเอาไว้ และยอมให้ผ่านเฉพาะไฟสลับ ดังนั้นเมื่อมีแรงดันไฟตรงป้อนกลับมาที่อินพุตกลับ ตัวเก็บประจุจะทำให้สัญญาณไฟตรงทั้งหมดไหลผ่านเข้าอินพุตกลับหักล้างกับแรงดันไฟตรง ที่จะออกทางเอาต์พุตได้ อัตราการขยายเท่ากับ 1



รูปที่ 2.30 การกำจัดแรงดันออฟเซตโดยการให้ขยายเฉพาะแรงดันที่เป็นไฟสลับ

เมื่อมีสัญญาณไฟสลับผ่านเข้ามาจากเอาต์พุต มันจะเลือกไหลผ่านตัวเก็บประจุลงดินไป เสมือนกับว่าตัวต้านทานค่า 10 กิโลโอห์ม ในวงจรถูกต่อลงดินกลายเป็นรูปทางขวามือล่าง เมื่อคำนวณ อัตราการขยายจากค่าของอุปกรณ์แล้วได้เท่ากับ 100 เท่า



รูปที่ 2.31 แสดงวิธีการปรับแรงดันออฟเซต

การปรับเพื่อลดขนาดแรงดันออฟเซตที่อินพุตสามารถทำได้ 2 วิธีคือ ใช้วงจรภายในของออปแอมป์เอง โดยต่ออุปกรณ์ปรับเข้ากับขาของออปแอมป์และอีกวิธีหนึ่งคือ ป้อนแรงดันจากภายนอกเข้าไปลบล้างผลของแรงดันออฟเซตนี้การป้อนแรงดันจากภายนอกแม้จะลดผลของออฟเซตไม่ให้ไปปรากฏที่เอาต์พุตได้จริง แต่อย่าลืมว่า แรงดันออฟเซตทางอินพุตของออปแอมป์ ก็ยังไม่ได้หายไปไหน

รูปที่ 2.31 ประกอบ

ซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เมื่อวงจรออปแอมป์ซับซ้อนขึ้น หรือในวงจรที่ใช้อะนาล็อกสวิทช์ (Analog switch) อะนาล็อกสวิทช์เป็นสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดหนึ่งมีการทำงานคล้ายคลึงกับรีเลย์ เพียงแต่ไม่มีหน้าสัมผัสเชิงกลแบบรีเลย์ ใช้ในการเปิดปิดสัญญาณไฟฟ้าภายในมักจะทำด้วยทรานซิสเตอร์หรือเฟ็ท อะนาล็อกสวิทช์ที่มีขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน มักจะเป็นชนิดที่ทำจากเฟ็ททั้งนั้น

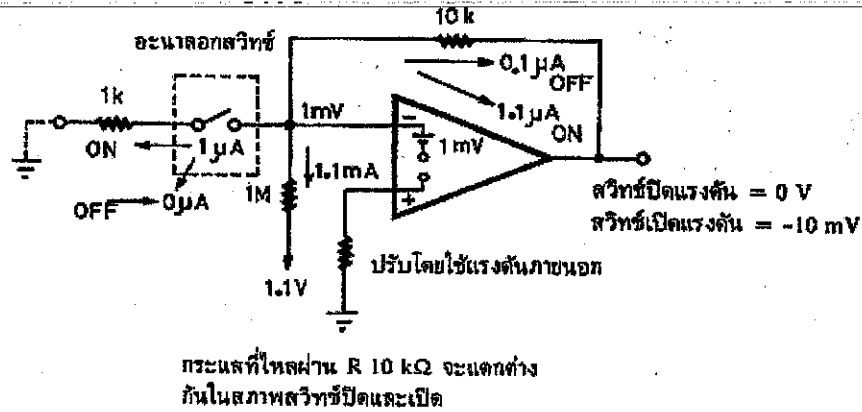
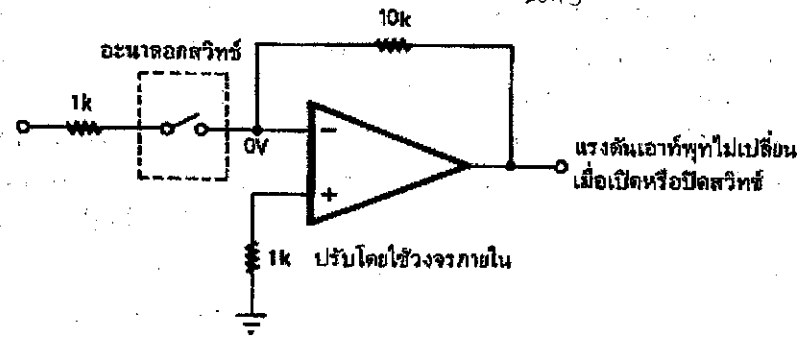
TK
2960
ว.392 ว
2545

4640103

13 ส.ค. 2546



สำนักหอสมุด



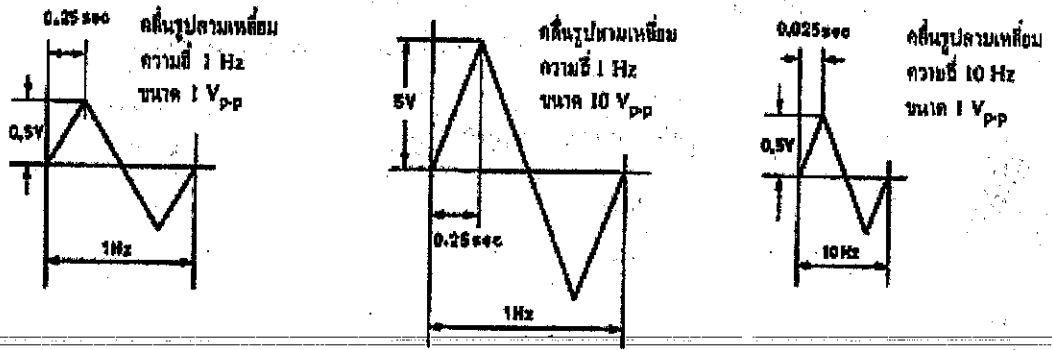
รูปที่ 2.32 แสดงการใช้อนาล็อกสวิทช์เพื่อเปิดปิดวงจรทางอินพุต

ดูตัวอย่างในรูปที่ 2.32 จะเห็นว่าการปรับออฟเซตโดยใช้แรงดันภายนอกจะทำให้เอาต์พุต มีแรงดันแตกต่างกันเมื่อสวิทช์อยู่ในสภาวะเปิดหรือปิด

2.4.2 ลักษณะสมบัติเชิงความถี่

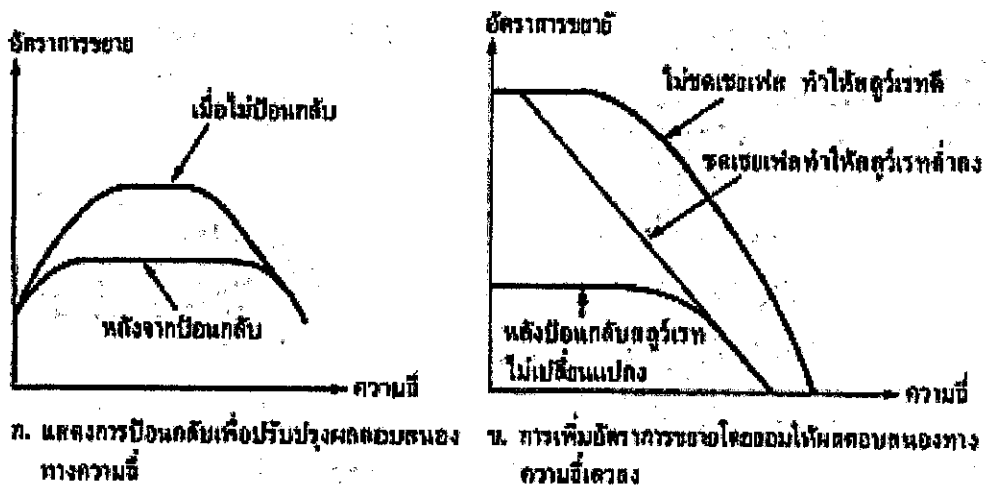
คุณสมบัติข้อนี้เรียกว่าเป็นตัวกำหนดความสามารถของออปแอมป์ที่เดียว ออปแอมป์จะดีไม่ดีก็มักดูกันที่ลักษณะเชิงความถี่นี้แต่มีคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งซึ่งมักจะดูควบคู่กันไปคือ สลัวเรท (Slew rate) สลัวเรท หมายถึง ความสามารถในการให้เอาต์พุต เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางอินพุต ที่ป้อนเข้ามา ถ้าป้อนแรงดันรูปคลื่นสี่เหลี่ยมซึ่งมีแอมพลิจูดใหญ่ให้กับออปแอมป์ แล้ววัดดูความเร็วในการขึ้นลงของรูปคลื่นทางเอาต์พุตจะได้เป็นค่าสลัวเรทออกมา

ตัวอย่างที่ 2.1 เอาต์พุตให้แรงดันที่เปลี่ยนแปลงไป 10 V ในเวลา 0.1 ms แสดงว่ามีสลัวเรท เท่ากับ $10 / 0.1 \mu s = 100 V / \mu s$ คลื่นสามเหลี่ยมความถี่ 1 Hz ขนาด 1 Vpp มีสลัวเรทเท่ากับ $0.5 V / 0.25 \mu s$ หรือ 2 V/s แต่ถ้าขนาดเพิ่มเป็น 10 Vpp ค่าสลัวเรทจะเป็น $5 V / 0.25 \mu s$ หรือ 20 V/s นั่นเอง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าตัว อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันนี้เราเรียกว่า สลัวเรท



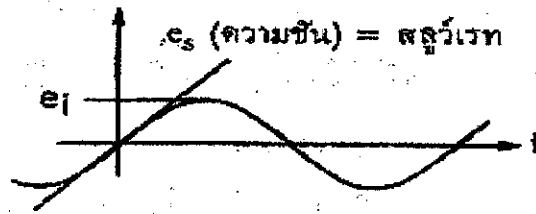
รูปที่ 2.33 รูปคลื่นที่เหมือนกัน ความถี่เท่ากันแต่ขนาดต่างกัน สลัวเรทจะไม่เท่ากัน

จากรูปที่ 2.33 การเพิ่มความถี่หรือเพิ่มขนาดสัญญาณ ให้ออปแอมป์ จะเป็นปัญหาทางด้านสลัวเรททั้งสิ้น การป้อนกลับจะทำให้ผลตอบสนองความถี่ของวงจรมีขั้วขึ้นจริง แต่จะไม่ทำให้สลัวเรทสูงขึ้นเลย แนวความคิดของการใช้วงจรป้อนกลับในสมัยก่อนนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงผลตอบสนองทางความถี่ให้ดีขึ้น ตามรูปที่ 2.34 แต่การใช้งานออปแอมป์ในปัจจุบัน มักจะไม่คำนึงถึงผลตอบสนองความถี่มากนักบางครั้งเพื่อให้ได้อัตราขยายของระบบสูงขึ้น อาจจะต้องทำให้ผลตอบสนองความถี่ลดลง โดยพยายามไม่ให้เกิดการออสซิลเลทเกิดขึ้นได้ง่าย



รูปที่ 2.34 ผลของการป้อนกลับ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสลัวเรท คือการที่จะให้รูปคลื่นที่สมบูรณ์มีขนาดใหญ่ได้เท่าใด ในขณะที่ความถี่สูงขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันกับผลตอบสนองทางความถี่เลย



$$e_s = \omega e_1 \cos \omega t$$

$$e_s (\text{max}) = 2\pi f e_1 \text{ (V/sec)}$$

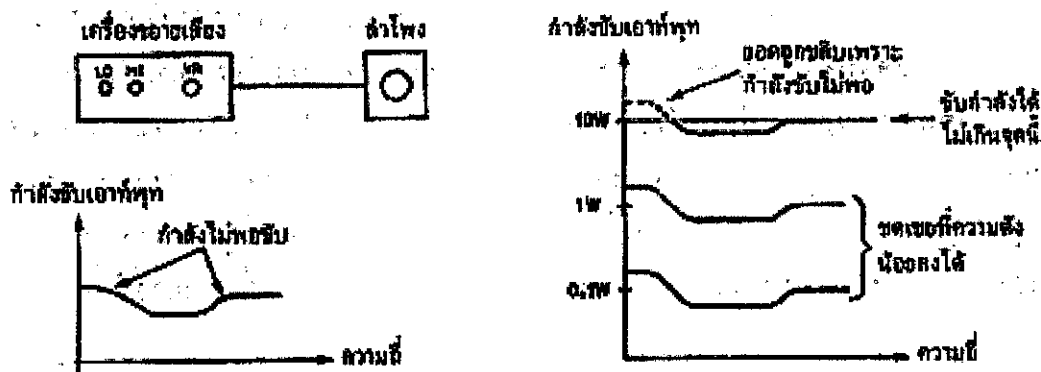
ที่ความถี่ 1 MHz ขนาด 20 V_{p-p} จะได้สลัว้เรทเท่ากับ

$$\begin{aligned} e_s (\text{max}) &= 2 \times 3.14 \times 10^6 \times 10 \\ &= 62.8 \times 10^6 \text{ (V/sec)} \\ &= 62.8 \text{ (V/}\mu\text{s)} \end{aligned}$$

รูปที่ 2.35 อัตราสลัว้เรทที่ดีทำให้ได้รูปขายน้ที่ไม่ผิดเพี้ยนจากการขยาย

ลองดูในรูปที่ 2.35 การที่ออปแอมป์จะสามารถผลิตสัญญาณรูปขายน้ความถี่ 1 MHz ขนาด 20 V_{p-p} ได้นั้น ออปแอมป์จะต้องมีสลัว้เรทดีถึง 62.8 V/S

ออปแอมป์เบอร์ LM741 ที่นิยมใช้กันนั้น มีสลัว้เรทเพียง 0.5 V / μ s หากนำมาผลิตรูปคลื่นขายน้ที่มีขนาด 20 V_{p-p} ก็คงจะได้ความถี่เพียงประมาณ 10 KHz เท่านั้นเอง แต่ถ้าใช้ LM741 เป็นบัฟเฟอร์ที่มีอัตราขยายเพียง 1 เท่า และพยายามผลิตสัญญาณให้ได้ 1 MHz จะได้ขนาดสัญญาณเพียง 0.1 V เท่านั้น



รูปที่ 2.36 ขีดความสามารถของโทนคอนโทรล

เปรียบเทียบการพยายามใช้โทนคอนโทรล ในการปรับให้เครื่องขยายเสียงที่มีก้าดิ่งน้อยขั้วเสียงด้าให้ดิ่งขึ้น ตามในรูปที่ 2.36 นั้นเอง

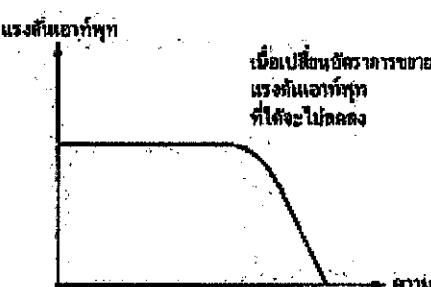
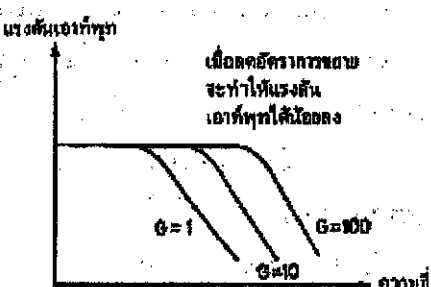
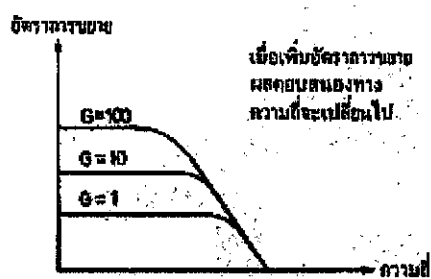
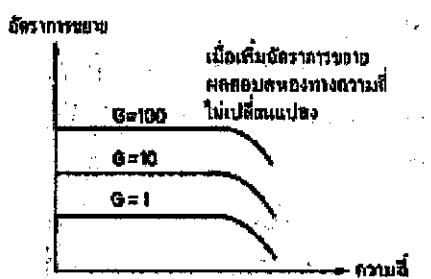
แต่ถ้าสจลว้เรทคี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผลตบสนองทางควมถี้จะคี้ตามไปค้ว ออปแอมป์ในสมัยแรก ๆ นิยมใช้เบอร์ LM709 ซึ่งเป็นออปแอมป์เบอร์ที่มีสจลว้เรท 2 V / microS แต่ในการใช้งานทุกคร้งจะต้องต่ออุปกรณ์ เพื่อชดเชยเฟสเสมอ ซึ่งจะมีผลทำให้ค่าสจลว้เรทต่ำลงจนอาจจะเร็วกว่า LM741 ซึ่งมีสจลว้เรทเพียง 0.5 V / microS จากรูปที่ 2.37 ประกอบ

การชดเชยเฟส มักจะทำให้ค่าสจลว้เรทต่ำลง แต่ก็มีวิธีชดเชยที่จะไม่ทำให้สจลว้เรทต่ำลง บางครั้งอาจทำได้คี้ขึ้นค้ว แต่ถ้าว้ใช้ออปแอมป์หลายตัวทำงานร่วมกัน จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องเสถียรภาพของการทำงานได้

ตารางที่ 2.1 การชดเชยเฟสของออปแอมป์เบอร์ LM709

อัตราขยาย	C ₁ (pF)	C ₂ (pF)	R ₁ (kΩ)	ผลตอบสนองความถี่	สจลว้เรท
1000	10	3	0	↑ เหมือนเดิม ↓	คี้ ↓ เร็ว
100	100	3	1.5		
10	470	22	1.5		
1	4700	220	1.5		

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่า การชดเชยเฟสให้ LM709 จะทำให้ผลตบสนองความถี่คี้ขึ้น แต่จะทำให้สจลว้เรทเลวลง เนื่องจากผลของตัวเก็บประจุที่ใช้ในการชดเชย ดูผลจากรูปที่ 2.37



ก. ออปแอมป์เบอร์ LM709 (ชดเชยเฟสภายนอก)

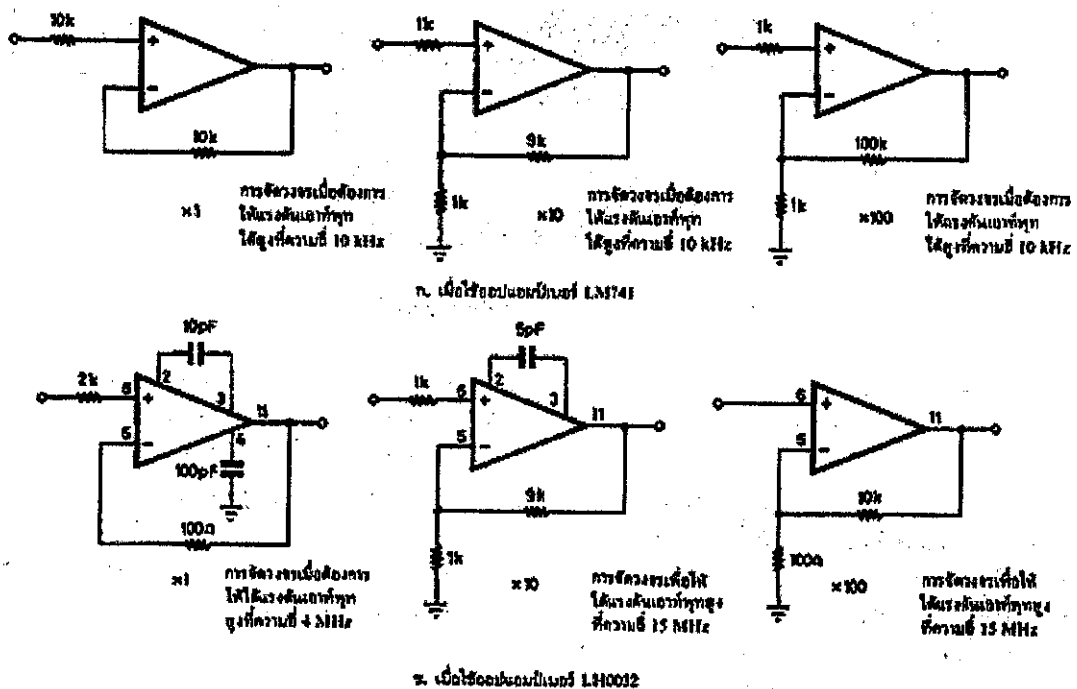
ข. LM741 (ชดเชยเฟสภายใน)

รูปที่ 2.37 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยายกับสจลว้เรท

การชดเชยเฟสจะต้องต่ออุปกรณ์ภายนอก แต่ค่า C และ R ที่เหมาะสมจะต้องปรับไปตามอัตรา
การขยายที่ต้องการ

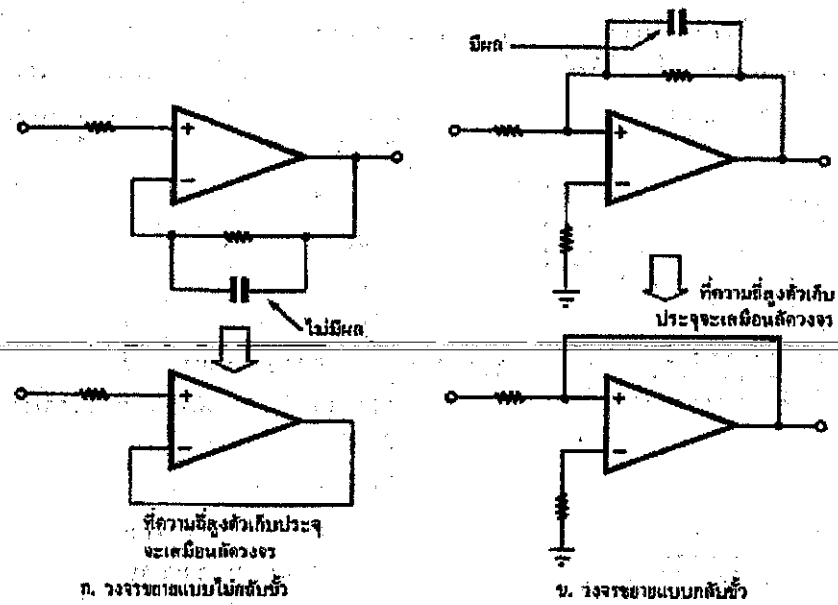
ออปแอมป์ในปัจจุบันนั้น จะมีวงจรชดเชยเฟสใส่ไว้ภายในตัวไอซี ไม่จำเป็นต้องต่ออุปกรณ์
ภายนอก และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดของอุปกรณ์ตามอัตราขยายที่ได้ แต่ถ้าใช้ในกรณีที่อัตราการ
ขยายสูงมาก จะทำให้ผลตอบสนองความถี่เลวลงไปได้

ออปแอมป์ความเร็วสูง ก็มีการชดเชยเฟสภายในเช่นเดียวกัน แต่การชดเชยจะน้อยที่สุด ดังนั้น
ในบางครั้งอาจจะต้องต่ออุปกรณ์ภายนอกช่วย เช่น เมื่อใช้กรณีที่อัตราการขยายสูงไม่ต้องต่ออุปกรณ์ชด
เชย แต่ถ้าอัตราการขยายต่ำจะต้องต่อตัวเก็บประจุชดเชยเป็นต้นดูรูปที่ 2.38 ประกอบ



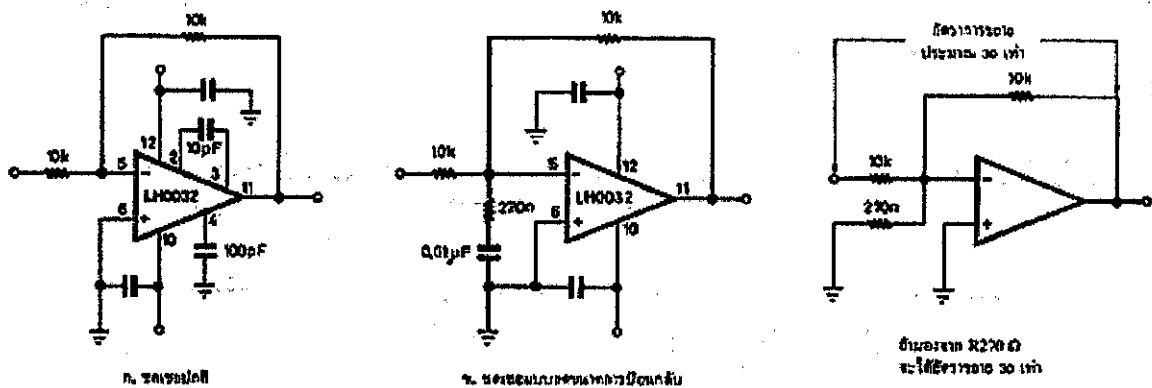
รูปที่ 2.38 อัตราการขยายของออปแอมป์ที่ความถี่แตกต่างกัน

ถ้าใช้ออปแอมป์ความเร็วสูง ที่มีอัตราขยายเพียง 1 จะต้องต่ออุปกรณ์ชดเชยเข้าไปหลายตัว
มีฉะนั้นการทำงานจะขาดเสถียรภาพ (ออสซิลเลตได้ง่ายมาก) การใส่ตัวเก็บประจุเข้าไปเพื่อชดเชยจะทำ
ให้สัญญาณรบกวน และคุณสมบัติการตอบสนองความถี่ในย่านความถี่สูงจะเกิดขดทำให้ไม่เป็นผลดีต่อ
การใช้งาน



รูปที่ 2.39 การต่อตัวเก็บประจุชดเชยเฟสขนานเข้ากับตัวต้านทานป้อนกลับ

การชดเชยเฟสในรูปที่ 2.39 จะใช้การต่อตัวเก็บประจุ คร่อมตัวต้านทานที่ใช้ในการป้อนกลับ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก จากในรูปจะเห็นว่า ในย่านความถี่สูงจะทำให้เสมือนเกิดลัดวงจรที่ตัวเก็บประจุ เป็นผลให้วงจรถายแบบไม่กลับขั้ว จะมีอัตราการขยายเหลือเพียง 1 และวงจรถายแบบกลับขั้ว จะมีอัตราการขยายเป็นศูนย์ ถ้าป้อนกลับมากเกินไป จะทำให้ออสซิลเลทง่าย แต่ถ้าป้อนกลับน้อยไปจะทำให้อัตราขยายสูงเกินไป



รูปที่ 2.40 การชดเชยเฟสที่สlew rate ไม่เปลี่ยนแปลง

วิธีการชดเชยเฟส โดยไม่ทำให้สlew rate ไม่เปลี่ยนแปลง แสดงในรูปที่ 2.40 รูป ก. การต่อตัวเก็บประจุจะทำให้สlew rate เบลอลง แต่รูป ข. สlew rate ไม่เบลอลง

ในย่านความถี่ต่ำตัวเก็บประจุขนาด 0.01 μF จะมีอิมพีแดนซ์สูง จนละลายได้ แต่ในย่านความถี่สูงจะเปรียบเหมือนลัดวงจร ทำให้อัตราการขยายของวงจรยังเท่าเดิม คือประมาณ 30 เท่า ขนาดของการป้อนกลับจะลดลง จึงไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยเฟส

2.5 โครงสร้างภายในไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 [5-6]

โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

- หน่วยความจำภายในสำหรับข้อมูลขนาด 128 ไบต์
- หน่วยความจำสำหรับเก็บ โปรแกรมขนาด 4 กิโลไบต์
- อุปกรณ์ควบคุมอินเตอร์รัพท์ ตัวตั้งเวลาและตัวนับขนาด 16 บิต 2 ชุด
- พอร์ตควบคุมการสื่อสารอนุกรมแบบ Full Duplex ซึ่งสามารถรับและส่งข้อมูลพร้อมกัน
- พอร์ตขนานสำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกจำนวน 4 พอร์ตๆ ละ 8 บิต
- วงจรผลิตสัญญาณนาฬิกาภายใน

2.5.1 หน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรม (Internal Program Memory)

หน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมทำหน้าที่เก็บโปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้น เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยหน่วยความจำจะเป็นแบบ ROM มีความจุ 4 KBytes (ตำแหน่ง 0000H - 0FFFH) ในการใช้งานเราสามารถกำหนดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเลือกใช้โปรแกรมที่เก็บอยู่ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือโปรแกรมที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำ (EPROM) ที่อยู่ภายนอกก็ได้ การเลือกการติดต่อทำได้โดย การป้อนสัญญาณควบคุมที่ขา EA \ (External Access) ถ้าต้องการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับโปรแกรมที่อยู่ในหน่วยความจำภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต่อขานี้กับลอจิก 1 หากต้องการให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ติดต่อกับโปรแกรมที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำภายนอก จะต่อขานี้กับลอจิก 0 การติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก จะติดต่อได้ทั้งหมด 64 KBytes (ตำแหน่ง 0000H - FFFFH) ในกรณีที่กำหนด ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับโปรแกรมที่อยู่ในหน่วยความจำ ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะติดต่อได้ 4 KBytes หากตำแหน่งของโปรแกรม มีค่าเกินกว่าตำแหน่งของหน่วยความจำภายใน (โปรแกรมมีความยาวเกินกว่า 4 KBytes) ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการติดต่อกับโปรแกรมที่อยู่ในหน่วยความจำภายนอกอัตโนมัติ

2.5.2 หน่วยความจำข้อมูลภายใน (Internal Data Memory)

หน่วยความจำข้อมูลภายในทำหน้าที่เก็บข้อมูลทั่วไป และทำหน้าที่เป็นสแตค (Stack) บางส่วน หน่วยความจำข้อมูลภายในเบอร์ 8051มีอยู่ 128 ไบต์ โดยอยู่ในตำแหน่ง 00H-7FH

2.5.3 อุปกรณ์ควบคุมการอินเตอร์รัพท์ (Interrupt Control Unit)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการอินเตอร์รัพท์ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีการร้องขออินเตอร์รัพท์ได้จาก 5 แหล่งกำเนิด คือ สัญญาณจากภายนอก 2 สัญญาณจากตัว Timer0 และ Timer1 และ

จากอุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบอนุกรม 1 สัญญาณ สัญญาณอินเทอร์รัพท์ที่เกิดขึ้น เราสามารถควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตอบรับหรือไม่ตอบรับก็ได้ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดลำดับความสำคัญของการอินเทอร์รัพท์ (Interrupt priority) จากสัญญาณต่างๆ ได้เป็น 2 ระดับแตกต่างกัน

2.5.4 ตัวตั้งเวลาและตัวนับ (Timer/Counter)

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 ประกอบด้วยรีจิสเตอร์ ตัวตั้งเวลา/ตัวนับ ขนาด 16 บิต จำนวน 2 ชุด คือ Timer0 และ Timer1 โดย Timer ทั้งหมดสามารถกำหนดให้ทำงานในลักษณะ ของตัวนับหรือตัวจับเวลาก็ได้ การทำงานในโหมดของตัวตั้งเวลา ค่าของรีจิสเตอร์จะเพิ่มขึ้นทุกๆ แมกซ์ไซเคิลโดย 1 แมกซ์ไซเคิล ประกอบด้วยสัญญาณนาฬิกา 12 ลูก ดังนั้นอัตราการจับเวลาจะเป็น $1/12$ เท่าของความถี่สัญญาณนาฬิกา ของระบบ ค่าสูงสุดที่ตั้งได้คือ 2 ยกกำลัง 16 การทำงานในโหมดการนับ ค่าของการนับจะเพิ่มขึ้น เมื่อสัญญาณเข้ามาที่ขา T0 และ T1 เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 ความเร็วในการนับสูงสุดคือ $1/24$ เท่าของสัญญาณนาฬิกา โดยสัญญาณที่เข้ามาที่ขา T0 หรือ T1 จะมี Duty Cycle เท่าใดก็ได้

2.5.5 พอร์ตอินพุตเอาต์พุต

ในไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 ประกอบด้วยพอร์ตอินพุตเอาต์พุตแบบ 2 ทิศทาง (Bidirectional) จำนวน 4 พอร์ต แต่ละพอร์ตมีอุปกรณ์แลตซ์ข้อมูล และเอาต์พุต ไดรเวอร์ประกอบอยู่ทางด้านเอาต์พุต และทางด้านอินพุตจะมีบัฟเฟอร์ (พอร์ตทั้ง 4 เป็นรีจิสเตอร์พิเศษชื่อ P0, P1, P2 และ P3) เราสามารถใช้งานแต่ละพอร์ตเป็นอินพุต หรือเอาต์พุตได้ตามต้องการ แต่ละบิตของพอร์ตสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ TTL ได้โดยตรง ในการติดต่อกับหน่วยความจำภายนอกพอร์ต P0 และ P2 จะใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของหน่วยความจำภายนอก โดยพอร์ต P0 จะทำงานในลักษณะของมัลติเพล็กซ์ คือเป็นทั้งพอร์ตตำแหน่งและ พอร์ตข้อมูล โดย P0 จะเป็นตำแหน่งของหน่วยความจำด้านต่ำ (Low byte) และ P2 จะเป็นตำแหน่งของหน่วยความจำด้านสูง (High byte)

2.5.6 สัญญาณต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051

สัญญาณต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 สามารถจำแนกตามการทำงานออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ

- กลุ่มสัญญาณตำแหน่ง เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของหน่วยความจำ
- กลุ่มสัญญาณควบคุม เป็นสัญญาณควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์
- กลุ่มสัญญาณข้อมูล ทางผ่านข้อมูลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับหน่วยความจำ

P1.0	1	40	VCC
P1.1	2	39	P0.0/AD0
P1.2	3	38	P0.1/AD1
P1.3	4	37	P0.2/AD2
P1.4	5	36	P0.3/AD3
P1.5	6	35	P0.4/AD4
P1.6	7	34	P0.5/AD5
P1.7	8	33	P0.6/AD6
RST	9	32	P0.7/AD7
RXD/P3.0	10	31	EA
TXD/P3.1	11	30	ALE
INT0/P3.2	12	29	PSKN
INT1/P3.3	13	28	P2.7/AD15
T0/P3.4	14	27	P2.6/AD14
T1/P3.5	15	26	P2.5/AD13
WR/P3.6	16	25	P2.4/AD12
RD/P3.7	17	24	P2.3/AD11
X-TAL1	18	23	P2.2/AD10
X-TAL2	19	22	P2.1/AD9
VCC	20	21	P2.0/AD8

รูปที่ 2.41 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 เป็นไอซีขนาด 40 ขา

Port 1 (P1.0 – P1.7)

เป็นพอร์ตอินพุต เอาท์พุตแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 8 บิต ที่มีพูลอัพ อยู่ในในกรณีเอาท์พุตจะต่อกับอินพุตของ TTL ตระกูล LS ได้ 4 ตัว เมื่อต้องการใช้เป็นอินพุต ต้องเริ่มต้นด้วยการส่งค่าลอจิก 1 ออกไปที่พอร์ตนี้ก่อน เพื่อทำให้เกิดพูลอัพภายใน เมื่อมีสัญญาณอินพุตเป็น 0 เข้ามาจะทำให้พอร์ตจ่ายกระแสออกเนื่องจากการพูลอัพอยู่ภายใน นอกจากนี้พอร์ต P1 ยังทำหน้าที่รับตำแหน่งด้านต่ำ ในช่วงของการโปรแกรม EPROM และช่วงการตรวจสอบโปรแกรมใน ROM หรือ EPROM

ขาสัญญาณรีเซท (RST)

เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกต้องทำให้ขาสัญญาณนี้เป็นลอจิก "1" อย่างน้อยประมาณ 2 แมกซ์ซีไนเซเคลิล หรือ 12 คาบเวลาของสัญญาณนาฬิกา จากนั้น CPU จึงจะเริ่มทำงานได้ และวงจรจะตรวจสอบสัญญาณรีเซททุกๆ คาบเวลาที่ 5 ของแต่ละแมกซ์ซีไนเซเคลิลเมื่ออยู่ในระหว่างการทำงานขาเรีเซทนี้ภายในจะมีวงจร schmitt trigger เพื่อขจัดสัญญาณรบกวน การรีเซท CPU จะเกิดขึ้นได้ 2 สถานภาพคือ เริ่มเปิดเครื่องครั้งแรกและอยู่ในระหว่างการทำงาน ถ้าอยู่ในระหว่างการทำงาน จะมีสัญญาณภายนอกมาป้อนเข้าที่ขาเรีเซทให้เป็นลอจิก "1" แต่ถ้าเป็นการเปิดเครื่องครั้งแรกต้องสร้างวงจรเพิ่มเติมขึ้นมาโดยใช้ ตัวต้านทานค่า 8.2 K ต่อลงกราวด์ และใช้ C ค่า 10 uF ต่อขึ้นไฟบวก การต่อแสดงดังภาพ

Vss

สำหรับต่อกับกราวด์

Vcc

สำหรับต่อกับไฟเลี้ยง 5 โวลต์

Port 0 (P0.0 – P0.7)

เป็นพอร์ตอินพุต 2 ทางแบบ Open drain ขนาด 8 บิต P0.0 - P0.7 เมื่อใช้เป็นเอาต์พุตสามารถต่อกับไอซี TTL ตระกูล LS ได้ 8 ตัว เมื่อต้องการใช้งานเป็นอินพุต ต้องส่งค่าลอจิก 1 ออกไปที่พอร์ตก่อนเพื่อทำให้ลอย ซึ่งจะเป็นอิมพีแดนซ์สูง พอร์ต P0 จะทำงานอีกหน้าที่หนึ่งคือ เป็นมัลติเพล็กซ์ของสัญญาณตำแหน่งค่าน้ำ และสัญญาณข้อมูลในการติดต่อกับหน่วย ความจำภายนอก การทำงานในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้การพูลอัพ (Pull up) จากภายใน ที่สามารถจ่ายกระแสให้กับอินพุตของ TTL ได้ 8 ตัว นอกจากนี้ 2 หน้าที่ดังกล่าวแล้ว พอร์ต P0 ยังใช้เป็นตัวรับข้อมูลในช่วงการ โปรแกรม EPROM และเป็นตัวส่งข้อมูล ออกมาในช่วงการตรวจสอบ โปรแกรมภายใน ROM หรือ EPROM ซึ่งจะต้องใช้พูลอัพจากภายนอก ในขณะที่ทำการตรวจสอบโปรแกรม การสร้างสัญญาณตำแหน่ง A0 - A7 และสัญญาณข้อมูล D0 - D7 ทำโดยใช้อุปกรณ์ แลทซ์ข้อมูล

อุปกรณ์ที่นำมาใช้แลทซ์ตำแหน่ง A0 - A7 ที่ออกมาจากพอร์ต P0 คือ ไอซี 74LS373 ซึ่งเป็น บิตแลทซ์

EA\ (External Access)

เป็นสัญญาณอินพุต ใช้สำหรับควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เลือกติดต่อกับโปรแกรมที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำโปรแกรมภายใน หรือโปรแกรมที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ หากให้ค่าลอจิก 1 ที่ขา นี้จะเป็นการเลือกใช้หน่วยความจำภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ หากต้องการให้ซีพียูติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก ต้องต่อสัญญาณเข้ากับลอจิก 0

ALE/PROG\ (Address Latch Enable)

เป็นสัญญาณเอาต์พุตซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งออกไปเป็นพัลส์เพื่อแลทซ์ค่าตำแหน่งไบต์ค่าที่อยู่ที่พอร์ต P0 ในขณะที่ติดต่อกับหน่วยความจำภายนอก สัญญาณนี้จะถูกส่งออกด้วยอัตราเร็วคงที่คือ 1/6 เท่าของความถี่สัญญาณนาฬิกาซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้ สัญญาณพัลส์นี้จะถูกข้ามไป 1 พัลส์เมื่อมีการติดต่อกับหน่วยความจำข้อมูลภายนอก EPROM และสัญญาณนี้จะใช้เป็นอินพุตเพื่อควบคุม โปรแกรม PROM ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย

PSEN\ (Program Store Enable)

เป็นเอาต์พุตสำหรับส่งสัญญาณสตrobe (พัลส์ต่ำ) เพื่ออ่านข้อมูลจากหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก External Program Memory เมื่อ CPU อ่านรหัสคำสั่งจากหน่วยความจำภายนอก จะส่ง

สัญญาณสโตนออกมา 2 ครั้งใน 1 แมกซ์ไซเคิล แต่สัญญาณสโตนทั้ง 2 ครั้งจะถูกข้ามไปหากเป็นช่วงที่ CPU ติดต่อกับ External Data Memory

Port 2

เป็นพอร์ตอินพุต เอาท์พุตแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 8 บิต ที่มีพูลอัพ อยู่ในในกรณีเอาท์พุตจะต่อกับอินพุตของ TTL ตระกูล LS ได้ 4 ตัว เมื่อต้องการใช้เป็นอินพุต ต้องเริ่มต้นด้วยการส่งค่าลอจิก 1 ออกไปที่พอร์ตนี้อีกก่อน เพื่อทำให้เกิดพูลอัพภายใน เมื่อมีสัญญาณอินพุตเป็น 0 เข้ามาจะทำให้พอร์ท P2 จ่ายกระแสออกเนื่องจากการพูลอัพภายใน ในระหว่างการติดต่อกับโปรแกรมภายนอก หรือการติดต่อกับหน่วยความจำข้อมูลภายนอก ที่มีการอ้าง ตำแหน่งแบบ 16 บิต พอร์ท P2 จะส่งตำแหน่งไบต์สูงออกไป ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะมีการพูลอัพภายในอยู่ ในช่วงของการติดต่อกับหน่วยความจำภายนอกที่ใช้การอ้างตำแหน่งแบบ 8 บิต(คำสั่ง MOVX @Ri) สัญญาณที่ขาของพอร์ท P2 จะมีค่าเท่ากับรีจิสเตอร์ P2 ที่อยู่ใน SFR นอกจากนี้พอร์ท P2 ยังทำหน้าที่รับตำแหน่งไบต์สูง ในช่วงของการโปรแกรม EPROM และการตรวจสอบโปรแกรมใน ROM และ EPROM อีกด้วย

2.5.7 การจัดหน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051

การจัดหน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 จะจัดแบ่งหน่วยความจำออกเป็น 3 กลุ่มคือ

1. หน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรม (Program Memory)
2. หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory)
3. รีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เฉพาะ (Special Function Register)

2.5.8 หน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรม (Program Memory)

หน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมจะเป็นที่เก็บชุดคำสั่งต่างๆ และข้อมูลที่โปรแกรมใช้งาน หน่วยความจำสำหรับเก็บ โปรแกรมแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

- หน่วยความจำโปรแกรมภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์
- หน่วยความจำภายนอกแบบตัวเดียว และ แบบหลายตัว

ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 มีหน่วยความจำที่เก็บโปรแกรมได้ 4 KBytes ซึ่งหน่วยความจำจะเป็นลักษณะของ ROM ในการใช้งานเราสามารถเก็บโปรแกรมเข้าในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ ทำให้ประหยัดการใช้หน่วยความจำภายนอก การติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051 สามารถติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรม ที่อยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือโปรแกรมที่เก็บอยู่ภายนอกก็ได้ โดยมีจำนวนข้อมูลทั้งหมด 64 KBytes การเลือกใช้หน่วยความจำภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051 สามารถเลือกใช้งานได้ 2 ลักษณะคือ เลือกใช้หน่วยความจำที่มีอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ มีอยู่ 4 KBytes รวมกับหน่วยความจำภายนอกอีก 60 KBytes หรือเลือกใช้หน่วยความจำภายนอกทั้งหมด 64 KBytes

การจัดหน่วยความจำโปรแกรมได้จำนวนตำแหน่งของหน่วยความจำทั้งหมดคือ 64 KBytes (ตำแหน่ง 0000H - FFFFH) หน่วยความจำโปรแกรมที่อยู่ในตัว 8051 มี 4 KBytes (ตำแหน่ง 0000H - FFFFH) ในการใช้งานเรากำหนดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้หน่วยความจำภายใน หรือภายนอกได้ โดยการควบคุมสัญญาณที่ขา EA (External Access) หากทำให้ EA เป็น 1 จะเป็นการเลือกใช้หน่วยความจำภายใน หากทำให้ EA เป็น 0 เป็นการเลือกใช้หน่วยความจำโปรแกรมภายนอก การเลือกใช้หน่วยความจำโปรแกรมจะทำได้เฉพาะหน่วยความจำในตำแหน่ง 0000H - 0FFFH ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ซ้อนกันระหว่าง หน่วยความจำภายในกับหน่วยความจำภายนอกเท่านั้น หากโปรแกรมที่อยู่ในตำแหน่งที่เกินกว่า 0FFFH ขึ้นไป ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทำการติดต่อกับหน่วยความจำภายนอกอัตโนมัติ ไม่ว่าสัญญาณ EA จะมีค่าเป็น 0 หรือ 1 ก็ตาม การจัดหน่วยความจำโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051

2.5.9 หน่วยความจำข้อมูล (Data Memory)

หน่วยความจำข้อมูลทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ในขณะที่โปรแกรมทำงาน และทำหน้าที่เป็นสแต็กบางส่วน ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 จัดแบ่งหน่วยความจำออกเป็น 2 ส่วนคือ

- หน่วยความจำข้อมูลภายใน
- หน่วยความจำข้อมูลภายนอก

2.5.10 หน่วยความจำข้อมูลภายนอก (External Data Memory)

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 สามารถติดต่อกับหน่วยความจำข้อมูลภายนอกได้ 64 KBytes เพิ่มเติมจากหน่วยความจำข้อมูลที่อยู่ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งต่อหน่วยความจำภายนอกเพิ่มเมื่อต้องการใช้พื้นที่โปรแกรมทำงานจำนวนมาก ตำแหน่งของหน่วยความจำข้อมูลภายนอกจะอยู่ที่ 0000H - FFFFH ในการใช้งานสามารถแบ่งส่วนหนึ่งของพื้นที่ของหน่วยความจำข้อมูลภายนอก มาใช้เป็นพอร์ตอินพุตหรือพอร์ตเอาต์พุตก็ได้

การติดต่อบริการส่งข้อมูลกับหน่วยความจำข้อมูลภายนอกจะใช้คำสั่ง MOVX สัญญาณต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยความจำข้อมูลภายนอกจะมี P0, P2, RD, WR โดยพอร์ต P0 จะเป็นสัญญาณตำแหน่งไบต์ค่า หรือข้อมูล ส่วนพอร์ต P2 เป็นสัญญาณตำแหน่งไบต์สูง สัญญาณ RD เป็นสัญญาณควบคุมการอ่านข้อมูล จากหน่วยความจำข้อมูลภายนอก จะแอกทีฟเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ ต้องการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำภายนอก ที่เกิดจากการทำงานของคำสั่ง MOVX A,@DPTR ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำข้อมูลในตำแหน่งที่กำหนดโดยรีจิสเตอร์ DPTR มาเก็บไว้ที่รีจิสเตอร์ A สัญญาณ WR เป็นสัญญาณควบคุมการบันทึกข้อมูล ลงในหน่วยความจำข้อมูลภายนอกจะแอกทีฟเมื่อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต้องการบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำข้อมูลภายนอก ซึ่งเกิดจากการทำงานของคำสั่ง MOVX @DPTR,A ไคอะแกรมของเวลาการอ่านข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำข้อมูล แสดงดังหน่วยความจำข้อมูลภายนอก ที่เรานำมาใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 นั้น

ส่วนใหญ่จะใช้ RAM แบบสแตติกเช่น เบอร์ 6264 (ขนาด 8 KBytes x 8) ตัวอย่างการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ กับหน่วยความจำข้อมูลภายนอก RAM 6264

สัญญาณ RD\ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต่อกับขา OE\ ของ RAM และ WR\ จะต่อกับ WE\ ของ RAM สัญญาณกำหนดตำแหน่งของหน่วยความจำ จะนำมาจากพอร์ต P0 และพอร์ต P2 สัญญาณข้อมูลจะมาจากพอร์ต P0 การต่อกับ RAM จะมีลักษณะคล้ายกับการต่อกับ EPROM หากต้องการต่อ RAM มากกว่า 1 ตัว ใช้ไอซี 74LS138 เป็นตัวถอดรหัสตำแหน่งของ RAM แต่ละตัวเช่นเดียวกับการต่อกับ EPROM